

产品特性

保证单调性

积分非线性(INL)误差: 最大值±1 LSB

1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源

温度范围: -40°C至+85°C

轨到轨输出放大器

省电模式

封装类型: 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)

用户接口:

并行

串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型接口,

提供数据回读)

I²C®兼容型

鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能

集成功能

通道监控

通过LDAC同时更新输出

清零至用户可编程代码功能

放大器升压模式可优化压摆率

用户可编程的失调和增益调整

Toggle模式支持方波生成

应用

可变光衰减器(VOA)

电平设置(ATE)

光微机电系统(MEMS)

控制系统

仪器仪表

功能框图

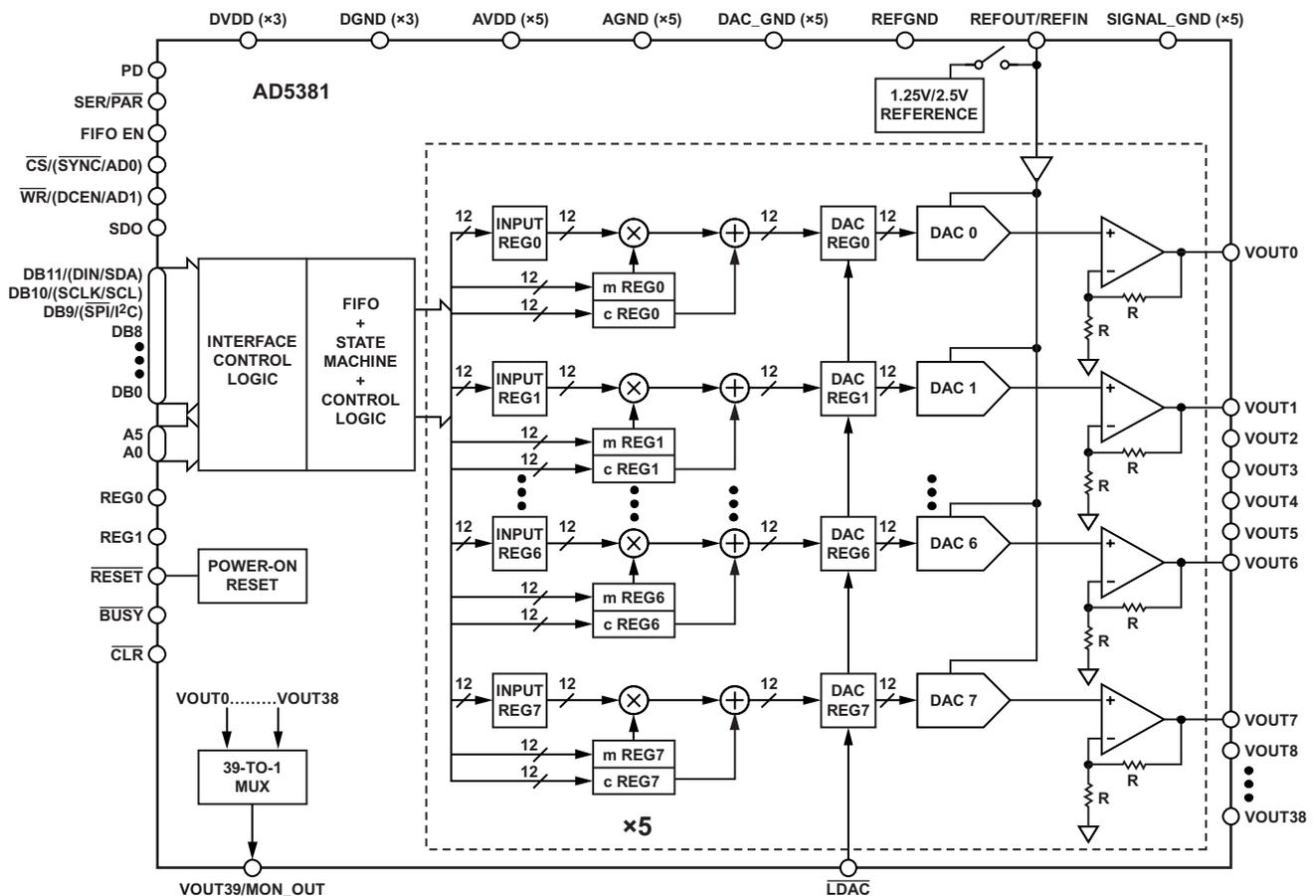


图1.

Rev. C

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 781.329.4700 www.analog.com
Fax: 781.461.3113 ©2004–2012 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

目录

概述.....	3	异步清零功能.....	25
技术规格.....	4	BUSY 和LDAC功能.....	25
AD5381-5技术规格.....	4	并行模式下的FIFO操作.....	25
AD5381-3技术规格.....	6	上电复位.....	25
交流特性.....	7	省电模式.....	25
时序特性.....	8	接口.....	26
串行接口时序.....	8	DSP、SPI、MICROWIRE兼容型串行接口.....	26
I ² C串行接口时序.....	10	I ² C串行接口.....	28
并行接口时序.....	11	并行接口.....	30
绝对最大额定值.....	13	微处理器接口.....	31
ESD警告.....	13	应用信息.....	33
引脚配置和功能描述.....	14	电源去耦.....	33
术语.....	17	典型配置电路.....	33
典型性能参数.....	18	监控功能.....	34
功能描述.....	21	Toggle模式功能.....	34
DAC架构—通用.....	21	热监控功能.....	34
数据解码.....	21	光衰减器.....	35
片内特殊功能寄存器.....	22	使用FIFO.....	35
SFR命令.....	22	外形尺寸.....	37
硬件功能.....	25	订购指南.....	37
复位功能.....	25		

修订历史

2012年5月—修订版B至修订版C

修改“特性”部分.....	1
更改表3.....	4
更改表4.....	6
更改表5的输出电压建立时间和压摆率参数.....	7
更改表6的 t_{14} 、 t_{17} 和 t_{19} 参数.....	8
更改表9.....	13
更改图10、图11和图14.....	18
更改图16至图18和图20.....	19
更新外形尺寸并更改订购指南.....	37

2005年8月—修订版A至修订版B

更改表2.....	3
更改技术规格部分.....	4
更改绝对最大额定值部分.....	13
更改图43.....	35
更改订购指南.....	37

2004年6月—数据手册从修订版0升级到修订版A

更改“订购指南”.....	36
---------------	----

2004年5月—修订版0：初始版

概述

AD5381是一款完整的单电源、40通道、12-bitDAC，提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚，以便进行外部监控，输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5381含有一个脉宽为20 ns \overline{WR} 的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400 kHz数据传输速率的I²C兼容型接口。

输入寄存器后置DAC寄存器可提供双缓冲，使各DAC输出既能独立更新，也能利用LDAC输入同时更新。

各通道均具有可编程的增益与失调调整寄存器，可以让用户对任何DAC通道进行全面校准。禁用升压模式时，该器件每个通道的典型功耗为0.25 mA。

表1. 产品系列中的其它低电压、单电源DAC

型号	分辨率	AVDD范围	输出通道数	线性误差(LSB)	封装描述	封装选项
AD5380BST-5	14 Bits	4.5 V 至 5.5 V	40	±4	100引脚 LQFP封装	ST-100
AD5380BST-3	14 Bits	2.7 V 至 3.6 V	40	±4	100引脚 LQFP封装	ST-100
AD5384BBC-5	14 Bits	4.5 V 至 5.5 V	40	±4	100引脚 CSPBGA	BC-80
AD5384BBC-3	14 Bits	2.7 V 至 3.6 V	40	±4	100引脚 CSPBGA	BC-80
AD5382BST-5	14 Bits	4.5 V 至 5.5 V	32	±4	100引脚 LQFP封装	ST-100
AD5382BST-3	14 Bits	2.7 V 至 3.6 V	32	±4	100引脚 LQFP封装	ST-100
AD5383BST-5	12 Bits	4.5 V 至 5.5 V	32	±1	100引脚 LQFP封装	ST-100
AD5383BST-3	12 Bits	2.7 V 至 3.6 V	32	±1	100引脚 LQFP封装	ST-100
AD5390BST-5	14 Bits	4.5 V 至 5.5 V	16	±3	52引脚 LQFP封装	ST-52
AD5390BCP-5	14 Bits	4.5 V 至 5.5 V	16	±3	64引脚 LFCSP	CP-64
AD5390BST-3	14 Bits	2.7 V 至 3.6 V	16	±4	52引脚 LQFP封装	ST-52
AD5390BCP-3	14 Bits	2.7 V 至 3.6 V	16	±4	52引脚 LQFP封装	CP-64
AD5391BST-5	12 Bits	4.5 V 至 5.5 V	16	±1	52引脚 LQFP封装	ST-52
AD5391BCP-5	12 Bits	4.5 V 至 5.5 V	16	±1	64引脚 LFCSP	CP-64
AD5391BST-3	12 Bits	2.7 V 至 3.6 V	16	±1	52引脚 LQFP封装	ST-52
AD5391BCP-3	12 Bits	2.7 V 至 3.6 V	16	±1	64引脚 LFCSP	CP-64
AD5392BST-5	14 Bits	4.5 V 至 5.5 V	8	±3	64引脚 LFCSP	ST-52
AD5392BCP-5	14 Bits	4.5 V 至 5.5 V	8	±3	64引脚 LFCSP	CP-64
AD5392BST-3	14 Bits	2.7 V 至 3.6 V	8	±4	52引脚 LQFP封装	ST-52
AD5392BCP-3	14 Bits	2.7 V 至 3.6 V	8	±4	64引脚 LFCSP	CP-64

表2. 40通道双极性电压输出DAC

型号	分辨率	模拟电源	输出通道数	线性误差	封装	封装选项
AD5379ABC	14 Bits	±11.4 V 至 ±16.5 V	40	±3	108引脚 CSPBGA	BC-108
AD5378ABC	14 Bits	±11.4 V 至 ±16.5 V	32	±3	108引脚 CSPBGA	BC-108

AD5381

技术规格

AD5381-5 SPECIFICATIONS

AVDD = 4.5 V至5.5 V；DVDD = 2.7 V至5.5 V，AGND = DGND = 0 V；外部REFIN = 2.5 V；除非另有说明，所有规格均相对 T_{MIN} 至 T_{MAX} 而言。

表3.

参数	AD5381-5 ¹	单位	测试条件/注释
精度			输出端无负载
分辨率	12	Bits	
相对精度 ² (INL)	±1	LSB(最大值)	
差分非线性(DNL)	±1	LSB(最大值)	在工作温度范围内保证单调性
零刻度误差	4	mV(最大值)	
失调误差	±4	mV(最大值)	线性区内代码8处测得
失调误差TC	±5	μV/°C(典型值)	
增益误差	±0.05	%FSR(最大值)	25°C时
增益温度系数 ³	±0.06	%FSR(最大值)	T_{MIN} 至 T_{MAX}
直流串扰 ³	2	ppm FSR/°C(典型值)	
直流串扰 ³	1	LSB(最大值)	
基准电压输入/输出			
基准输入 ³			
基准输入电压	2.5	V	±1%(额定性能)，AVDD = 2 x REFIN + 50 mV
直流输入阻抗	1	MΩ(最小值)	100 MΩ(典型值)
输入电流	±10	μA(最大值)	±30 nA(典型值)
基准电压范围	1 to AVDD/2	V(最小值/最大值)	
基准输出 ⁴			通过AD5381控制寄存器中的CR8使能；CR10可选择基准电压
输出电压	2.495/2.505 1.22/1.28	V(最小值/最大值) V(最小值/最大值)	环境温度下；针对2.5 V操作优化。 CR10 = 1
基准电压TC	±10 ±15	ppm/°C(最大值) ppm/°C(最大值)	温度范围：+25°C至+85°C 温度范围：-40°C至+85°C
输出阻抗	800	Ω(典型值)	
输出特性 ³			
输出电压范围 ²	0/AVDD	V(最小值/最大值)	
短路电流	40	mA(最大值)	
负载电流	±1	mA(最大值)	
容性负载稳定性			
$R_L = \infty$	200	pF(最大值)	
$R_L = 5 \text{ k}\Omega$	1000	pF(最大值)	
直流输出阻抗	0.6	Ω(最大值)	
监控引脚			
输出阻抗	1	kΩ(典型值)	
三态漏电流	100	nA(典型值)	
逻辑输入(SDA/SCL除外) ³			DVDD = 2.7 V至5.5 V
输入高电压 V_{IH}	2	V(最小值)	
输入低电压 V_{IL}			
DVDD > 3.6 V	0.8	V(最大值)	
DVDD ≤ 3.6 V	0.6	V(最大值)	
输入电流	±10	μA(最大值)	所有引脚总和； $T_A = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}
引脚电容	10	pF(最大值)	

参数	AD5381-5 ¹	单位	测试条件/注释
逻辑输入(仅限SDA、SCL) ³			
输入高电压 V_{IH}	$0.7 \times DVDD$	V(最小值)	当 $DVDD < 3.6$ V时, 此接口为SMBus兼容 当 $DVDD < 3.6$ V时, 此接口为SMBus兼容
输入低电压 V_{IL}	$0.3 \times DVDD$	V(最大值)	
I_{IN} , 输入漏电流	± 1	μ A(最大值)	
V_{HYST} , 输入迟滞	$0.05 \times DVDD$	V(最小值)	
输入电容 C_{IN}	8	pF(典型值)	
毛刺抑制	50	ns(最大值)	输入滤波可抑制小于50 ns的噪声尖峰
逻辑输出(BUSY, SDO) ³			
输出低电压 V_{OL}	0.4	V(最大值)	$DVDD = 5$ V $\pm 10\%$, 200 μ A吸电流 $DVDD = 5$ V $\pm 10\%$, 200 μ A吸电流
输出高电压 V_{OH}	$DVDD - 1$	V(最小值)	
输出低电压 V_{OL}	0.4	V(最大值)	$DVDD = 2.7$ V至3.6 V, 200 μ A吸电流 $DVDD = 2.7$ V至3.6 V, 200 μ A吸电流
输出高电压 V_{OH}	$DVDD - 0.5$	V(最小值)	
高阻抗漏电流	± 1	μ A(最大值)	仅限SDO(串行数据输出)
高阻抗输出电容	5	pF(典型值)	仅限SDO(串行数据输出)
逻辑输出(SDA) ³			
输出低电压 V_{OL}	0.4	V(最大值)	$I_{SINK} = 3$ mA $I_{SINK} = 6$ mA
	0.6	V(最大值)	
三态漏电流	± 1	μ A(最大值)	
三态输出电容	8	pF(典型值)	
电源要求			
AVDD	4.5/5.5	V(最小值/最大值)	输出端空载, 且禁用升压模式。0.25 mA/通道(典型值) 输出端空载, 且启用升压模式。0.325 mA/通道(典型值) $V_{IH} = DVDD, V_{IL} = DGND$ 100 nA(典型值) 1 μ A(典型值) 输出端空载, 且禁用升压模式。AVDD = DVDD = 5 V
DVDD	2.7/5.5	V(最小值/最大值)	
电源灵敏度 ³ $\Delta Midscale/\Delta AV_{DD}$	-85	dB(典型值)	
AI_{DD}	0.375	mA/通道(最大值)	
	0.475	mA/通道(最大值)	
DI_{DD}	1	mA(最大值)	
AI_{DD} (省电模式)	20	μ A(最大值)	
DI_{DD} (省电模式)	20	μ A(最大值)	
功耗	80	mW(最大值)	

¹ AD5381-5使用外部2.5 V基准电压源进行校准。所有型号产品的温度范围: -40°C至+85°C。

² 在 $V_{OUT} = 10$ mV至 $AVDD - 50$ mV的范围内可保证精度。

³ 通过特性保证, 但未经生产测试。

⁴ AD5381-5上默认为2.5 V。可通过AD5381控制寄存器中的CR10编程为1.25 V; 以1.25 V基准电压源操作AD5381-5会导致精度下降。

AD5381

AD5381-3技术规格

AVDD = 2.7 V至3.6 V；DVDD = 2.7 V至5.5 V，AGND = DGND = 0 V；外部REFIN = 1.25 V；除非另有说明，所有规格均相对于 T_{MIN} 至 T_{MAX} 而言。

表4.

参数	AD5381-3 ¹	单位	测试条件/注释
精度			输出端无负载
分辨率	12	Bits	
相对精度 ² (INL)	±1	LSB(最大值)	
差分非线性(DNL)	±1	LSB(最大值)	在工作温度范围内保证单调性
零刻度误差	4	mV(最大值)	
失调误差	±4	mV(最大值)	线性区内代码16处测得
失调误差TC	±5	μV/°C(典型值)	
增益误差	±0.05	%FSR(最大值)	25°C时
增益温度系数 ³	±0.1	%FSR(最大值)	T_{MIN} 至 T_{MAX}
增益温度系数 ³	2	ppm FSR/°C(典型值)	
直流串扰 ³	1	LSB(最大值)	
基准电压输入/输出			
基准输入 ³			
基准输入电压	1.25	V	±1%(额定性能)，AVDD = 2 x REFIN + 50 mV
直流输入阻抗	1	MΩ(最小值)	100 MΩ(典型值)
输入电流	±10	μA(最大值)	±30 nA(典型值)
基准电压范围	1 to AVDD/2	V(最小值/最大值)	
基准输出 ⁴			通过AD5381控制寄存器中的CR8使能；CR10可选择基准电压
输出电压	1.245/1.255 2.47/2.53	V(最小值/最大值) V(最小值/最大值)	环境温度下；针对1.25 V操作优化；CR10 = 0 CR10 = 1
基准电压TC	±10 ±15	ppm/°C(最大值) ppm/°C(最大值)	温度范围：+25°C至+85°C 温度范围：-40°C至+85°C
输出阻抗	800	Ω(典型值)	
输出特性 ³			
输出电压范围 ²	0/AVDD	V(最小值/最大值)	
短路电流	40	mA(最大值)	
负载电流	±1	mA(最大值)	
容性负载稳定性			
$R_L = \infty$	200	pF(最大值)	
$R_L = 5\text{ k}\Omega$	1000	pF(最大值)	
直流输出阻抗	0.6	Ω(最大值)	
监控引脚			
输出阻抗	1	kΩ(典型值)	
三态漏电流	100	nA(典型值)	
逻辑输入(SDA/SCL除外) ³			DVDD = 2.7 V至3.6 V
输入高电压 V_{IH}	2	V(最小值)	
输入低电压 V_{IL}			
DVDD > 3.6 V	0.8	V(最大值)	
DVDD > 3.6 V	0.6	V(最大值)	
输入电流	±1	μA(最大值)	所有引脚总和； $T_A = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}
引脚电容	10	pF(最大值)	
逻辑输入(仅限SDA、SCL) ³			
输入高电压 V_{IH}	$0.7 \times DVDD$	V(最小值)	当DVDD < 3.6 V时，此接口为SMBus兼容
输入低电压 V_{IL}	$0.3 \times DVDD$	V(最大值)	当DVDD < 3.6 V时，此接口为SMBus兼容
I_{IN} ，输入漏电流	±1	μA(最大值)	
V_{HYST} ，输入迟滞	$0.05 \times DVDD$	V(最小值)	
输入电容 C_{IN}	8	pF(典型值)	
毛刺抑制	50	ns(最大值)	输入滤波可抑制小于50 ns的噪声尖峰

参数	AD5381-3 ¹	单位	测试条件/注释
逻辑输出(BUSY, SDO) ³ 输出低电压 V_{OL} 输出高电压 V_{OH} 高阻抗漏电流 高阻抗输出电容	0.4 DVDD - 0.5 ± 1 5	V(最小值) V(最大值) μA (最大值) pF(典型值)	吸电流200 μA 源电流200 μA 仅限SDO(串行数据输出) 仅限SDO(串行数据输出)
逻辑输出(SDA) ³ 输出低电压 V_{OL} 三态漏电流 三态输出电容	0.4 0.6 ± 1 8	V(最大值) V(最小值) μA (最大值) pF(典型值)	$I_{SINK} = 3 \text{ mA}$ $I_{SINK} = 6 \text{ mA}$
电源要求 AVDD DVDD 电源灵敏度 ³ $\Delta \text{Midscale} / \Delta AV_{DD}$ AI_{DD} DI_{DD} AI_{DD} (省电模式) DI_{DD} (省电模式) 功耗	2.7/3.6 2.7/5.5 -85 0.375 0.475 1 20 20 48	V(最小值/最大值) V(最小值/最大值) dB(典型值) mA/通道(最大值) mA/通道(最大值) mA(最大值) μA (最大值) μA (最大值) mW(最大值)	输出端空载, 且禁用升压模式。0.25 mA/通道(典型值) 输出端空载, 且禁用升压模式。0.325 mA/通道(典型值) $V_{IH} = DVDD, V_{IL} = DGND$ 100 nA(典型值) 1 μA (典型值) 输出端空载, 且禁用升压模式。AVDD = DVDD = 3 V

¹ AD5381-3使用外部1.25 V基准电压源进行校准。温度范围: -40°C至+85°C。

² 在 $V_{OUT} = 10 \text{ mV}$ 至 $AVDD - 50 \text{ mV}$ 的范围内可保证精度。

³ 通过特性保证, 但未经生产测试。

⁴ AD5381-3上默认为1.25 V。可通过AD5381控制寄存器中的CR10编程为2.5 V; 以2.5 V基准电压源操作AD5381-3会导致精度下降和输入代码范围受限。

交流特性¹

AVDD = 4.5 V至5.5 V或2.7 V至3.6 V; DVDD = 2.7 V至5.5 V; AGND = DGND = 0 V。

表5.

参数	All	单位	测试条件/注释
动态性能			
输出电压建立时间	3 8	μs (典型值) μs (最大值)	1/4至3/4满量程输入变化, 精度达到 $\pm 1 \text{ LSB}$
压摆率 ²	1.5 2.5	V/ μs (典型值) V/ μs (典型值)	禁用升压模式, 且CR9 = 0 启用升压模式, 且CR9 = 1
数模转换毛刺能量	12	nV-s(典型值)	
毛刺脉冲峰值幅度	15	mV(典型值)	
DAC间串扰	1	nV-s(典型值)	参见术语部分。
数字串扰	0.8	nV-s(典型值)	
数字馈通	0.1	nV-s(典型值)	输入总线对受测DAC输出的影响
输出噪声(0.1 Hz至10 Hz)	15 40	μV p-p(典型值) μV p-p(典型值)	外部基准电压源, 中间电平载入DAC 内部基准电压源, 中间电平载入DAC
输出噪声频谱密度			
在1 kHz条件下	150	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ (典型值)	
在10 kHz条件下	100	nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ (典型值)	

¹ 通过设计和特性保证, 但未经生产测试。

² 压摆率可以通过AD5381控制寄存器中的电流升压控制位进行编程。

时序特性

串行接口时序

DVDD = 2.7 V至5.5 V；AVDD= 4.5 V至5.5 V或2.7 V至3.6 V；AGND = DGND = 0 V；除非另有说明，所有规格均相对于 T_{MIN} 至 T_{MAX} 而言。

表6.

参数 ^{1,2,3}	在 T_{MIN} 、 T_{MAX} 的限值	单位	描述
t_1	33	ns(最小值)	SCLK周期时间
t_2	13	ns(最小值)	SCLK高电平时间
t_3	13	ns(最小值)	SCLK低电平时间
t_4	13	ns(最小值)	\overline{SYNC} 下降沿到SCLK下降沿建立时间
t_5^4	13	ns(最小值)	第24个SCLK下降沿到 \overline{SYNC} 下降沿
t_6^4	33	ns(最小值)	\overline{SYNC} 最短低电平时间
t_7	10	ns(最小值)	\overline{SYNC} 最短高电平时间
t_{7A}	50	ns(最小值)	回读模式下 \overline{SYNC} 最短高电平时间
t_8	5	ns(最小值)	数据建立时间
t_9	4.5	ns(最小值)	数据保持时间
t_{10}^4	30	ns(最大值)	第24个SCLK下降沿到 \overline{BUSY} 下降沿
t_{11}	670	ns(最大值)	\overline{BUSY} 低电平脉宽(单通道更新)
t_{12}^4	20	ns(最小值)	第24个SCLK下降沿到 \overline{LDAC} 下降沿
t_{13}	20	ns(最小值)	\overline{LDAC} 低电平脉冲宽度
t_{14}	2	μ s(最大值)	\overline{BUSY} 上升沿到DAC输出响应时间
t_{15}	0	ns(最小值)	\overline{BUSY} 上升沿到 \overline{LDAC} 下降沿
t_{16}	100	ns(最小值)	\overline{LDAC} 下降沿到DAC输出响应时间
t_{17}	3	μ s(典型值)	DAC输出建立时间
t_{18}	20	ns(最小值)	\overline{CLR} 低电平脉冲宽度
t_{19}	40	μ s(最大值)	\overline{CLR} 脉冲启动时间
t_{20}^5	20	ns(最大值)	SCLK上升沿到SDO有效
t_{21}^5	5	ns(最小值)	SCLK下降沿到 \overline{SYNC} 上升沿
t_{22}^5	8	ns(最小值)	\overline{SYNC} 上升沿到SCLK上升沿
t_{23}	20	ns(最小值)	\overline{SYNC} 上升沿到 \overline{LDAC} 下降沿

¹ 通过设计和特性保证，但未经生产测试。

² 所有输入信号均指定 $t_r = t_f = 5$ ns(10%至90% V_{CC})并从1.2 V电平起开始计时。

³ 参见图2、图3、图4和图5。

⁴ 只限独立模式。

⁵ 只限菊花链模式。

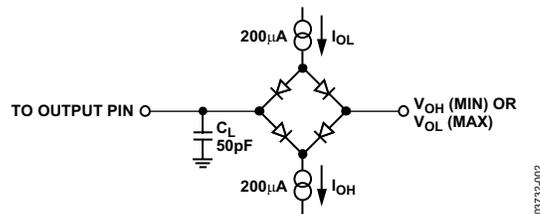


图2. 用于确定数字输出时序的负载电路

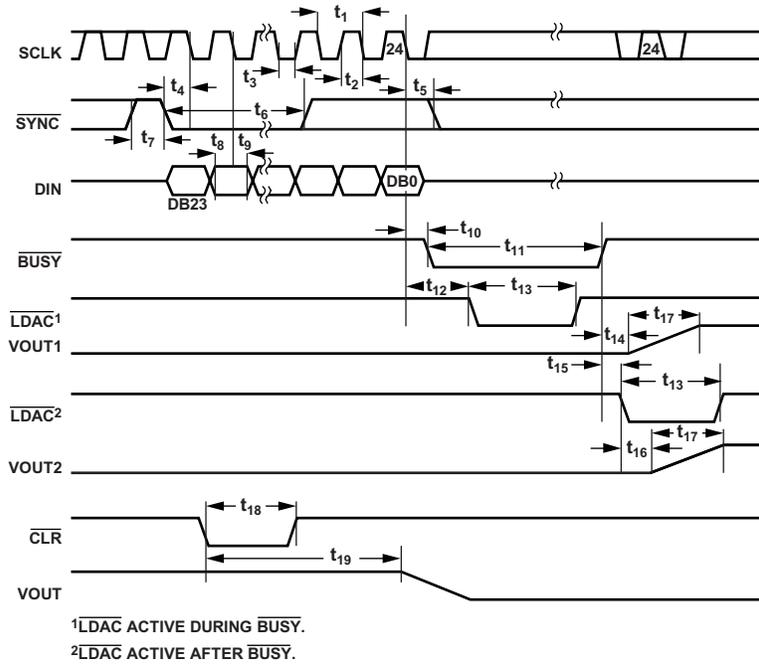


图3. 串行接口时序图(独立模式)

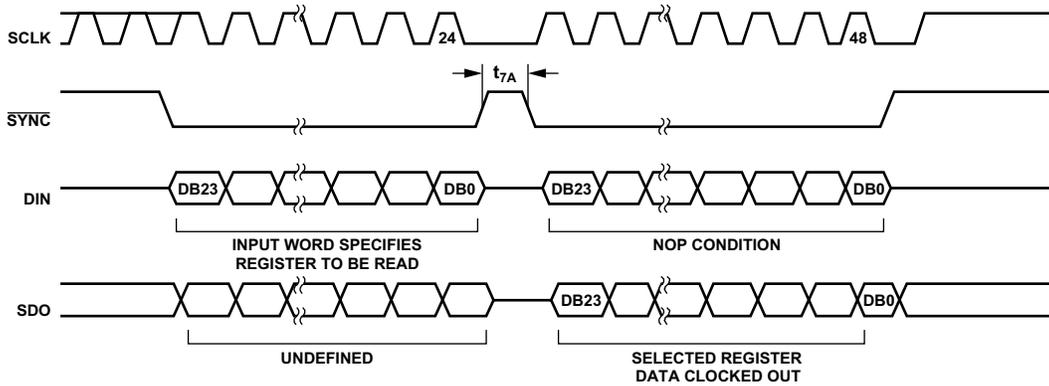


图4. 串行接口时序图(数据回读模式)

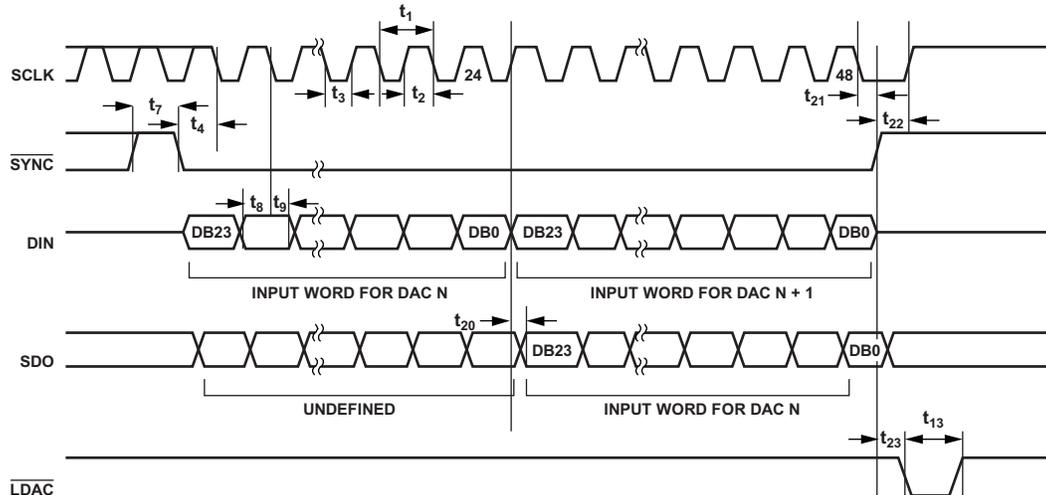


图5. 串行接口时序图(菊花链模式)

I²C串行接口时序

DVDD = 2.7 V至5.5 V；AVDD= 4.5 V至5.5 V或2.7 V至3.6 V；AGND = DGND = 0 V；除非另有说明，所有规格均相对于T_{MIN}至T_{MAX}而言。

表7.

参数 ^{1,2}	在T _{MIN} 、T _{MAX} 的限值	单位	描述
F _{SCL}	400	kHz(最大值)	SCL时钟频率
t ₁	2.5	μs(最小值)	SCL周期时间
t ₂	0.6	μs(最小值)	t _{HIGH} , SCL高电平时间
t ₃	1.3	μs(最小值)	t _{LOW} , SCL低电平时间
t ₄	0.6	μs(最小值)	t _{HD,STA} , 起始/重复起始条件保持时间
t ₅	100	ns(最小值)	t _{SU,DAT} , 数据建立时间
t ₆ ³	0.9	μs(最大值)	t _{HD,DAT} , 数据保持时间
t ₇	0	μs(最小值)	t _{HD,DAT} , 数据保持时间
t ₈	0.6	μs(最小值)	t _{SU,STA} , 重复起始建立时间
t ₉	0.6	μs(最小值)	t _{SU,STO} , 停止条件建立时间
t ₁₀	1.3	μs(最小值)	t _{BUF} , 一个停止条件与一个起始条件之间的总线空闲时间
t ₁₁	300	ns(最大值)	t _R , 接收时SCL和SDA的上升时间
t ₁₂	0	ns(最小值)	t _R , 接收时(CMOS兼容)SCL和SDA的上升时间
t ₁₃	300	ns(最大值)	t _F , 发射时SDA的下降时间
t ₁₄	0	ns(最小值)	t _F , 接收时(CMOS兼容)SDA的下降时间
t ₁₅	300	ns(最大值)	t _F , 接收时SCL和SDA的下降时间
t ₁₆	20 + 0.1 C _b ⁴	ns(最小值)	t _F , 发射时SCL和SDA的下降时间
C _b	400	pF(最大值)	各条总线的容性负载

¹ 通过设计和特性保证，但未经生产测试。

² 参见图6。

³ 主器件必须为SDA信号(参考SCL信号的VIH最小值)提供至少300 ns的保持时间，以便桥接SCL下降沿的未定义区域。

⁴ C_b是一条总线的总电容(单位为pF)。t_R和t_F是在0.3 DVDD至0.7 DVDD范围内测得的。

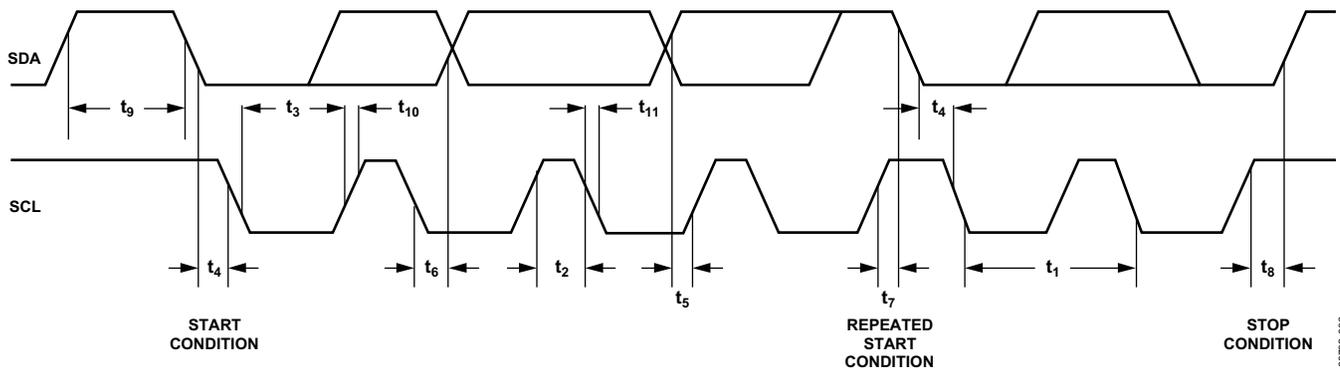


图6. I²C兼容型串行接口时序图

并行接口时序

DVDD = 2.7 V至5.5 V；AVDD = 4.5 V至5.5 V或2.7 V至3.6 V；AGND = DGND = 0 V；除非另有说明，所有规格均相对于 T_{MIN} 至 T_{MAX} 而言。

表8.

参数 ^{1,2,3}	在 T_{MIN} 、 T_{MAX} 的限值	单位	描述
t_0	4.5	ns(最小值)	REG0、REG1地址到 \overline{WR} 上升沿建立时间
t_1	4.5	ns(最小值)	REG0、REG1地址到 \overline{WR} 上升沿保持时间
t_2	20	ns(最小值)	\overline{CS} 低电平脉冲宽度
t_3	20	ns(最小值)	\overline{WR} 低电平脉冲宽度
t_4	0	ns(最小值)	\overline{CS} 到 \overline{WR} 下降沿建立时间
t_5	0	ns(最小值)	\overline{WR} 到 \overline{CS} 上升沿保持时间
t_6	4.5	ns(最小值)	数据到 \overline{WR} 上升沿建立时间
t_7	4.5	ns(最小值)	数据到 \overline{WR} 上升沿保持时间
t_8	20	ns(最小值)	\overline{WR} 高电平脉宽
t_9 ⁴	700	ns(最小值)	\overline{WR} 最小周期时间(单通道写入)
t_{10} ⁴	30	ns(最大值)	\overline{WR} 上升沿到 \overline{BUSY} 下降沿
t_{11} ^{4,5}	670	ns(最大值)	\overline{BUSY} 低电平脉宽(单通道更新)
t_{12}	30	ns(最小值)	\overline{WR} 上升沿到LDAC下降沿
t_{13}	20	ns(最小值)	LDAC 低电平脉冲宽度
t_{14}	100	ns(最大值)	\overline{BUSY} 上升沿到DAC输出响应时间
t_{15}	20	ns(最小值)	LDAC 上升沿到 \overline{WR} 上升沿
t_{16}	0	ns(最小值)	\overline{BUSY} 上升沿到LDAC下降沿
t_{17}	100	ns(最小值)	LDAC 下降沿到DAC输出响应时间
t_{18}	8	μ s(典型值)	DAC输出建立时间(禁用升压模式)
t_{19}	20	ns(最小值)	\overline{CLR} 低电平脉冲宽度
t_{20}	12	μ s(最大值)	\overline{CLR} 脉冲启动时间

¹ 通过设计和特性保证，但未经生产测试。

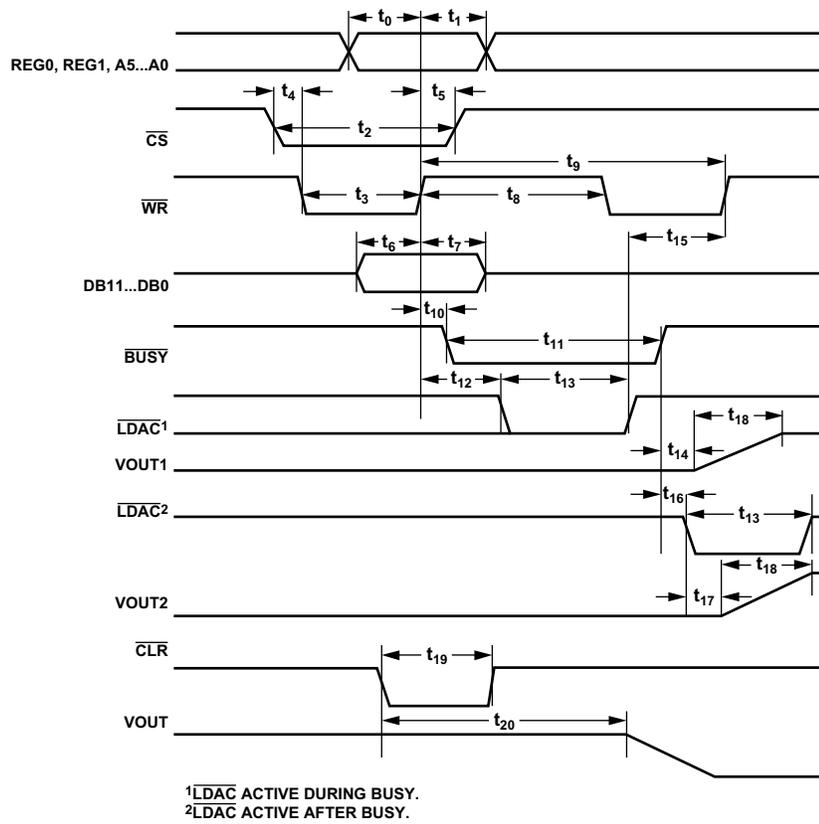
² 所有输入信号均规定为 $t_R = t_F = 5$ ns(10%至90% DV_{DD}) 并从1.2 V电平起开始计时。

³ 参见图7。

⁴ 参见图29。

⁵ 用图2中的负载电路测量。

AD5381



03732-507

图7. 并行接口时序图

绝对最大额定值

除非另有说明， $T_A = 25^\circ\text{C}$ 。¹

表9.

参数	额定值
AVDD 至 AGND	-0.3 V 至 +7 V
DVDD 至 DGND	-0.3 V 至 +7 V
数字输入至DGND	-0.3 V 至 DVDD + 0.3 V
SDA/SCL 至 DGND	-0.3 V 至 +7 V
数字输出至DGND	-0.3 V 至 DVDD + 0.3 V
REFIN/REFOUT 至 AGND	-0.3 V 至 AVDD + 0.3 V
AGND 至 DGND	-0.3 V 至 +0.3 V
VOUTx 至 AGND	-0.3 V 至 AVDD + 0.3 V
模拟输入至AGND	-0.3 V 至 AVDD + 0.3 V
工作温度范围	
商用(B级)	-40°C 至 +85°C
存储温度范围	-65°C 至 +150°C
结温(TJ 最大值)	150°C
100引脚LQFP封装	
θ_{JA} 热阻	44°C/W
回流焊	
峰值温度	230°C
回流焊(无铅)	
峰值温度	260(0/-5)°C
峰值温度时间	10秒至40秒
ESD	
HBM	6.5 kV
FICDM	2 kV

¹ 100 mA以下的瞬态电流不会造成SCR闩锁。

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。

ESD警告

ESD(静电放电)敏感器件。静电电荷很容易在人体和测试设备上累积，可高达4000 V，并可能在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专用ESD保护电路，但在遇到高能量静电放电时，可能会发生永久性器件损坏。因此，建议采取适当的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。



AD5381

引脚配置和功能描述

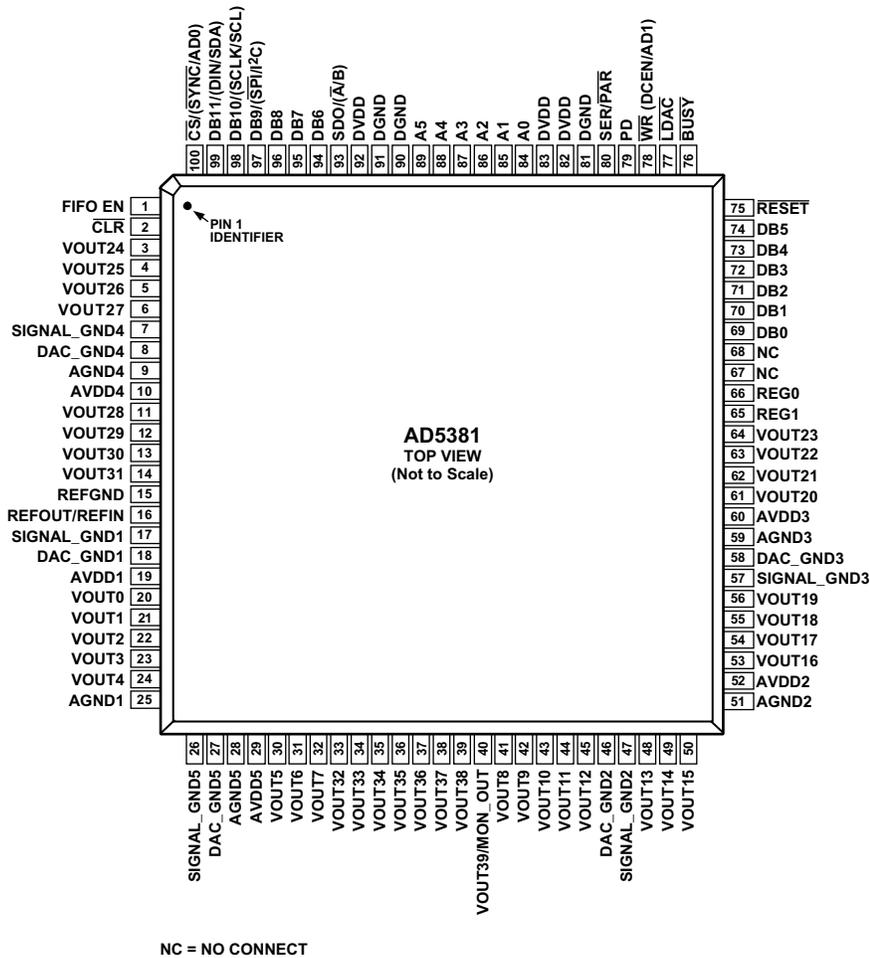


图8. 100引脚LQFP的引脚配置

表10. 引脚功能描述

引脚名称	功能
VOUTx	通道x的缓冲模拟输出。各模拟输出均由增益设置为2的轨到轨输出放大器驱动。各输出均能够驱动5 kΩ的输出负载到地。典型输出阻抗为0.5 Ω。
SIGNAL_GND(1-5)	每个八输出通道组的模拟地基准点。所有SIGNAL_GND引脚均内部连接在一起，并应连接到尽可能靠近AD5381的AGND平面。
DAC_GND(1-5)	每个八通道组均包含一个DAC_GND引脚。这是内部12-bit DAC的地基准点。这些引脚应连接到AGND平面。
AGND(1-5)	模拟参考点。每个八通道组均包含一个AGND引脚。所有AGND引脚均应从外部连接到AGND平面。
AVDD(1-5)	模拟电源引脚。每个八通道组均有一个独立的AVDD引脚。这些引脚内部短接并应使用0.1 μF陶瓷电容和10 μF钽电容去耦。AD5381-5的工作电压范围为4.5 V至5.5 V；AD5381-3的工作电压范围为2.7 V至3.6 V。
DGND	所有数字电路的地。
DVDD	逻辑电源。保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V。建议使用0.1 μF陶瓷电容和10 μF钽电容将这些引脚去耦到DGND。
REFGND	内部基准电压源的地基准点。

引脚名称	功能
REFOUT/REFIN	AD5381包含一个REFOUT/REFIN共用引脚。当选择内部基准电压源时，此引脚为基准输出。如果应用中要求使用外部基准电压源，则可将其施加于此引脚，内部基准电压源可通过控制寄存器来禁用。此引脚默认使用基准输入。
VOUT39/MON_OUT	双功能引脚。默认模式下，此引脚用作通道39的缓冲输出。使能监控功能时，此引脚用作39至1通道多路复用器的输出端，可通过编程将通道0至38中的一个通道多路复用至MON_OUT引脚。MON_OUT引脚的典型输出阻抗为500 Ω，用于驱动SAR ADC输入端等的高输入阻抗。
SER/ $\overline{\text{PAR}}$	接口选择输入。此引脚可使用户选择是使用串行接口还是并行接口。如果要连接高电平，则选择串行接口模式，引脚97 (SPI/I ² C)用于判断接口模式是SPI还是I ² C。当SER/ $\overline{\text{PAR}}$ 为低电平时，则选择并行接口模式。
$\overline{\text{CS}}$ / $\overline{\text{SYNC}}$ /AD0	在并行接口模式下，此引脚用作片选输入(电平敏感、低电平有效)。低电平时选择AD5381。串行接口模式。这是串行时钟和数据的帧同步输入信号。 I ² C模式。此引脚用作硬件地址引脚，与AD1一起用来判断I ² C总线上此器件的软件地址。
$\overline{\text{WR}}$ /(DCEN/AD1)	多功能引脚。在并行接口模式下，此引脚用作写入使能。在串行接口模式下，此引脚用作菊花链使能(SPI模式)和硬件地址引脚(I ² C模式)。 并行接口写入(边沿敏感)。WR上升沿与 $\overline{\text{CS}}$ 低电平一起使用，并且地址总线输入写入所选器件寄存器。 串行接口。菊花链选择输入(电平敏感、高电平有效)。高电平时，此信号与SER/ $\overline{\text{PAR}}$ 高电平一起使用，以使能SPI串行接口菊花链模式。 I ² C模式。此引脚用作硬件地址引脚，与AD0一起用来判断I ² C总线上此器件的软件地址。
DB11–DB0	并行数据总线。DB11为AD5381上输入数据字的MSB，而DB0则为LSB。
A5–A0	并行地址输入。A5至A0均经过解码来寻址AD5381的40个输入通道之一。与REG1和REG0引脚一起使用，来判断输入数据的目标寄存器。
REG1, REG0	在并行接口模式下，REG1和REG0用于解码输入数据的目标寄存器。REG1和REG0均经过解码来寻址所选通道的输入数据寄存器、偏移寄存器或增益寄存器，并且还用于确定特殊功能寄存器。
SDO/ $\overline{\text{A/B}}$	串行接口模式中的串行数据输出。三态CMOS输出。SDO可用于以菊花链形式将多个器件连接在一起。数据在SCLK上升沿通过SDO逐个输出，而且在SCLK的下降沿有效。 在并行接口模式下，当选择toggle模式并向AD5381数据寄存器写入数据时，此引脚用作A或B数据寄存器选择(参见“Toggle模式功能”部分)。在toggle模式下，LDAC用于在A和B数据寄存器所含数据之间切换输出。所有DAC通道均包含两个数据寄存器。在正常模式下，数据寄存器A是数据传输的默认寄存器。
BUSY	CMOS数字输出。在对载入DAC数据寄存器的数据(x2)进行内部计算时， $\overline{\text{BUSY}}$ 变为低电平。在此期间，用户可以继续向x1、c和m寄存器写入新数据，但无法进一步更新DAC寄存器和DAC输出。如果BUSY处于低电平时LDAC被拉低，则会存储此事件。此外，上电复位期间，以及RESET引脚处于低电平时， $\overline{\text{BUSY}}$ 同样会变为低电平。在此期间会禁用该接口并会忽略LDAC上的所有事件。CLR操作也会让BUSY变为低电平。
$\overline{\text{LDAC}}$	加载DAC逻辑输入(低电平有效)。如果在 $\overline{\text{BUSY}}$ 无效(高电平)时 $\overline{\text{LDAC}}$ 被拉低，输入寄存器的内容会被送入DAC寄存器，同时会更新DAC输出。如果在BUSY有效且正在进行内部计算时LDAC被拉低，则会在BUSY变为无效时存储LDAC事件并更新DAC寄存器。不过，将忽略上电复位期间LDAC上的所有事件或RESET上的所有事件。
$\overline{\text{CLR}}$	异步清零输入。 $\overline{\text{CLR}}$ 输入对下降沿敏感。当 $\overline{\text{CLR}}$ 被激活时，所有通道均会更新为 $\overline{\text{CLR}}$ 代码寄存器中所含的数据。在所有通道更新为CLR代码时，BUSY会保持低电平35 μs。
$\overline{\text{RESET}}$	异步数字复位输入(下降沿敏感)。此引脚的功能相当于上电复位发生器。当此引脚被拉低时，状态机将启动复位时序，通过数字形式将x1、m、c和x2寄存器复位到其默认上电值。此序列通常耗时270 μs。RESET的下降沿将启动RESET过程。在此期间，BUSY将变为低电平，并在RESET完成后返回高电平。当BUSY处于低电平时，将禁用所有接口并忽略所有LDAC脉冲。当BUSY返回高电平时，器件恢复正常操作，并忽略RESET引脚的状态，直至检测到下一下降沿。

AD5381

引脚名称	功能
PD	省电模式(电平敏感、高电平有效)。PD用于将器件置于低功耗模式。在该模式下,模拟功耗降至2 μ A,数字功耗降至20 μ A。在省电模式下,所有内部模拟电路均置于低功耗模式,而模拟输出则配置为高阻抗输出或提供100 k Ω 负载到地,具体取决于省电模式的配置方式。在省电期间,串行接口会保持活动状态。
FIFO EN	FIFO使能(电平敏感、高电平有效)。连接到DVDD时,内部FIFO使能,从而允许用户全速写入器件。FIFO只能在并行接口模式下使用。器件会在上电时和CLEAR或RESET之后对FIFO EN引脚的状态进行采样,从而判断是否已使能FIFO。在串行或I ² C接口模式下, FIFO EN引脚应连接低电平。
DB9/($\overline{\text{SPI}}$ /I ² C)	多功能输入引脚。在并行接口模式下,此引脚用作并行输入数据字的DB9。在串行接口模式下,此引脚用作串行接口模式选择。当选择串行接口模式(SER/PAR = 1)且此输入处于低电平时,将选择SPI模式。在SPI模式下,DB12为串行时钟(SCLK)输入,DB11为串行数据(DIN)输入。 当选择并行接口模式(SER/PAR = 1)且此输出处于高电平时,将选择I ² C模式。
DB10/(SCLK/SCL)	在此模式下,DB12为串行时钟(SCL)输入,DB11为串行数据(SDA)输入。 多功能输入引脚。在并行接口模式下,此引脚用作并行输入数据字的DB10。在串行接口模式下,此引脚用作串行时钟输入。 串行接口模式。在串行接口模式下,数据在SCLK下降沿读入移位寄存器。工作时钟速率最高达50 MHz。
DB11/(DIN/SDA)	I ² C模式。在I ² C模式下,此引脚执行SCL功能,将数据读入器件。I ² C模式下的数据传输速率与100 kHz和400 kHz工作模式兼容。 多功能数据输入引脚。在并行接口模式下,此引脚用作并行输入数据字的DB11。 串行接口模式。在串行接口模式下,此引脚用作串行数据输入。数据必须在SCLK的下降沿有效。 I ² C模式。在I ² C模式下,此引脚为用作开漏输入/输出的串行数据引脚(SDA)。

术语

相对精度

相对精度或端点线性度是指DAC输出与通过DAC端点的传递函数直线之间的最大偏差。在零刻度误差和满量程误差调零后才可以进行相对精度测量，单位为LSB。

差分非线性

差分非线性是指任意两个相邻代码之间所测得变化值与理想的1 LSB变化值之间的差异。最大1 LSB的额定差分非线性可确保单调性。

零刻度误差

零刻度误差指DAC寄存器中加载全0时DAC输出电压的误差。理想情况下，DAC全部载入0且 $m = \text{全}1$ ， $c = 2^n - 1$

$$V_{OUT(\text{零刻度})} = 0 \text{ V}$$

零刻度误差是指 V_{OUT} (实际)和 V_{OUT} (理想)之间的差值，以mV为单位。该误差主要是由输出放大器中的失调造成的。

失调误差

失调误差是指传递函数线性区内 V_{OUT} (实际)和 V_{OUT} (理想)之间的差值，以mV为单位。失调误差在AD5381-5上是通过将代码32载入DAC寄存器测得的，在AD5381-3上是通过载入代码64测得的。

增益误差

增益误差针对的是 $V_{OUT} = 10 \text{ mV}$ 和 $V_{OUT} = AV_{DD} - 50 \text{ mV}$ 之间的输出范围的线性区。它是指DAC传递特性的斜率与理想值之间的偏差，在DAC输出端空载时用满量程范围的百分比(%FSR)表示。

直流串扰

直流串扰是指一个中间电平DAC的输出电平在响应满量程码(全0至全1，或相反)和所有其他DAC的输出变化时发生的直流变化，以LSB为单位。

直流输出阻抗

直流输出阻抗是指有效的输出源电阻，主要是封装引脚电阻。

输出电压建立时间

输出电压建立时间是指对于 $1/4$ 至 $3/4$ 满量程输入变化，DAC输出达到并保持在额定电平所需的时间。它在 \overline{BUSY} 上升沿进行测量。

数模转换毛刺能量

数模转换毛刺能量是指主编码跃迁时注入模拟输出端的能量。它定义为毛刺的面积，并用nV-s表示。它的测量方法是将DAC寄存器数据在0x7FF与0x800之间进行切换。

DAC间串扰

DAC间串扰是指一个DAC的输出端因数字变化和另一DAC的后续模拟输出变化而出现的毛刺脉冲。受影响通道采用中间电平载入。DAC间串扰单位为nV-s。

数字串扰

数字串扰是指一个转换器的输出端因另一转换器的DAC寄存器代码发生变化而产生的毛刺脉冲，单位为nV-s。

数字馈通

当该器件未被选中时，器件数字输入端上的高频逻辑活动可以贯穿整个器件进行容性耦合，表现为 V_{OUT} 引脚上的噪声。它也可以沿电源线和地线耦合。这种噪声就是数字馈通。

输出噪声频谱密度

输出噪声频谱密度是衡量内部产生的随机噪音的一种指标。随机噪声表示为频谱密度(每 $\sqrt{\text{Hz}}$ 电压)。测量方法是将所有DAC加载到中间电平，然后测量输出端的噪声。它是在10 kHz下1 Hz带宽内测量的，单位为 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

典型工作特性

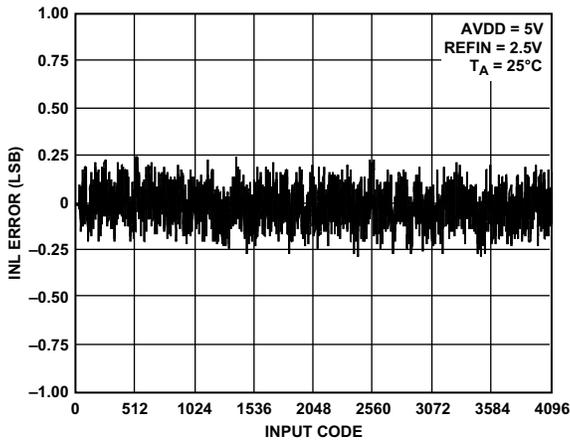


图9. AD5381-5典型INL曲线图

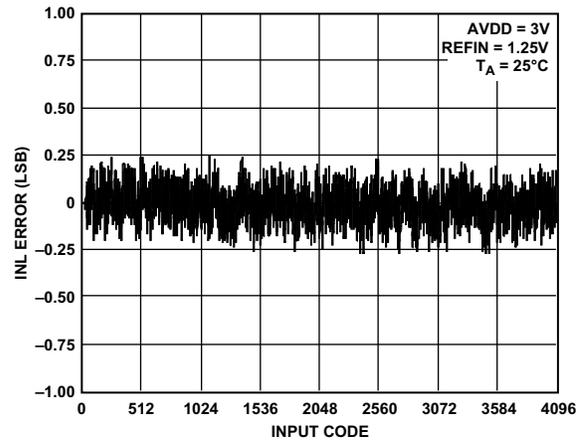


图12. AD5381-3典型INL曲线图

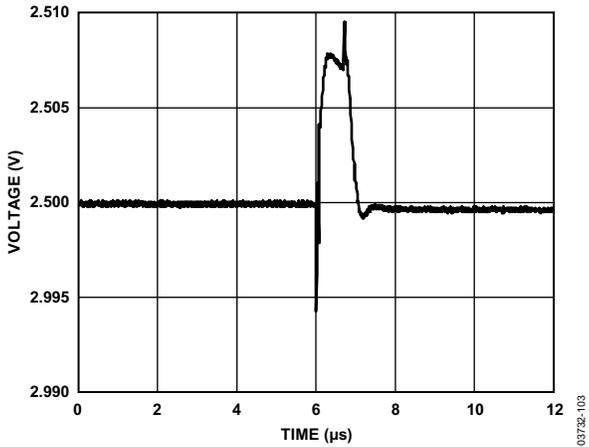


图10. AD5381-5毛刺脉冲

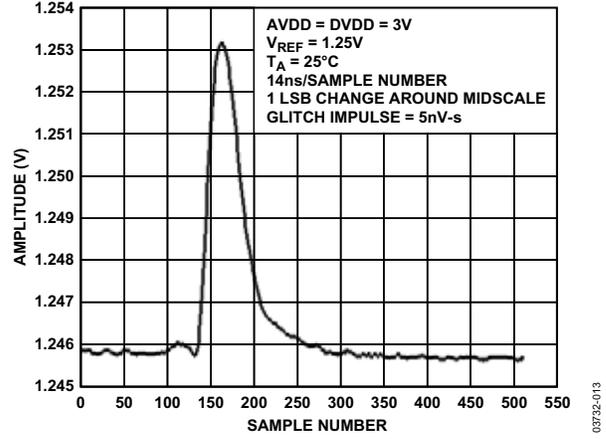


图13. AD5381-3毛刺脉冲

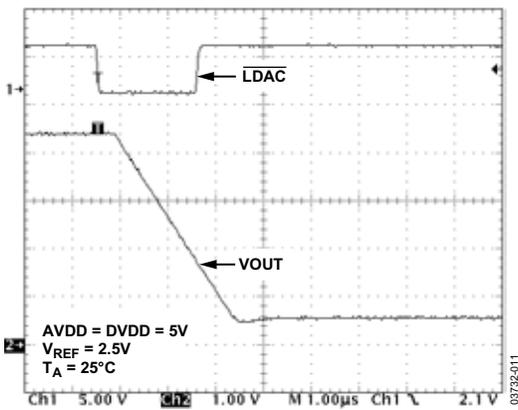


图11. 禁用升压模式时的压摆率

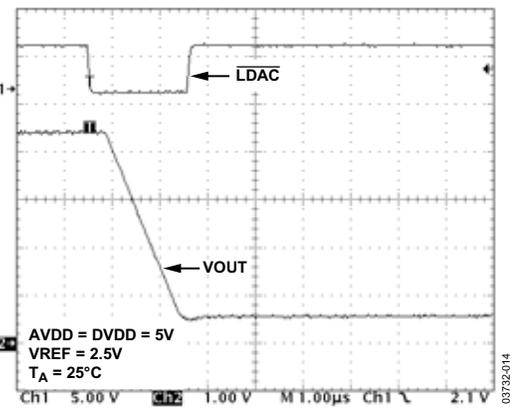


图14. 启用升压模式时的压摆率

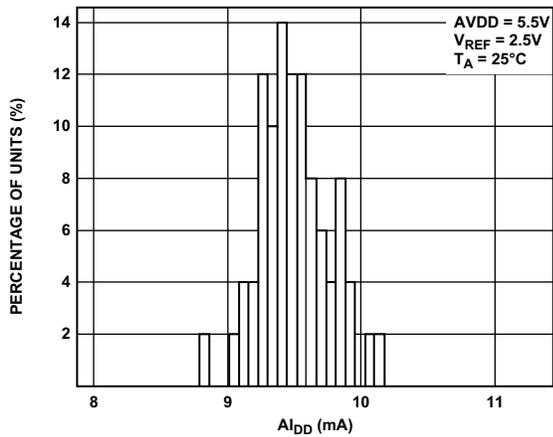


图15. 禁用升压模式时的 $A I_{DD}$ 直方图

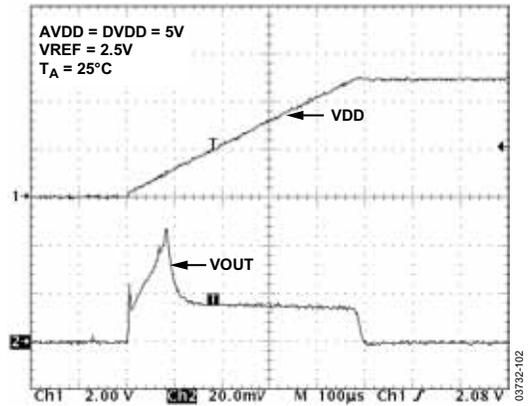


图18. 上电瞬变

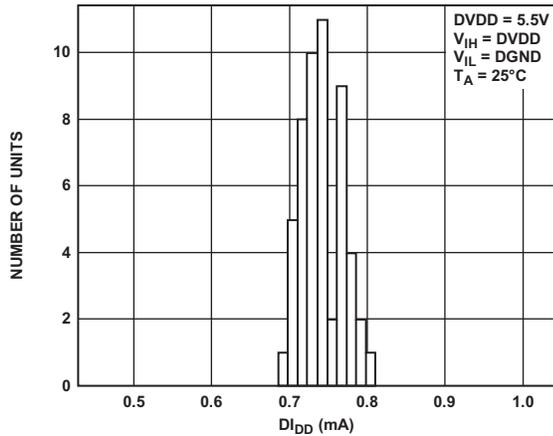


图16. $D I_{DD}$ 直方图

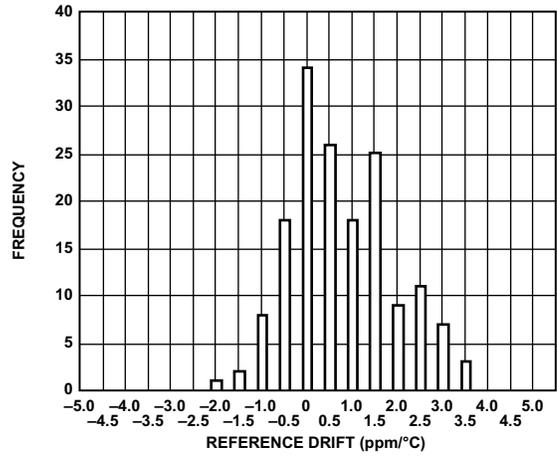


图19. REFOUT温度系数

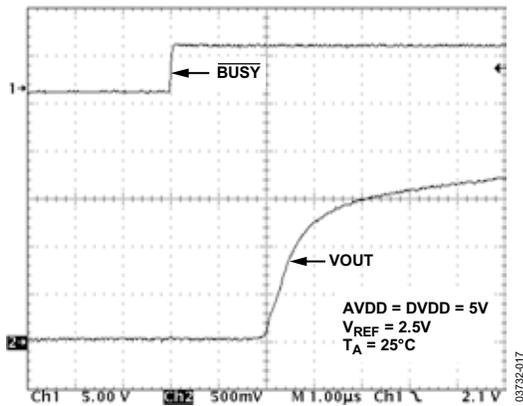


图17. 退出软件省电模式

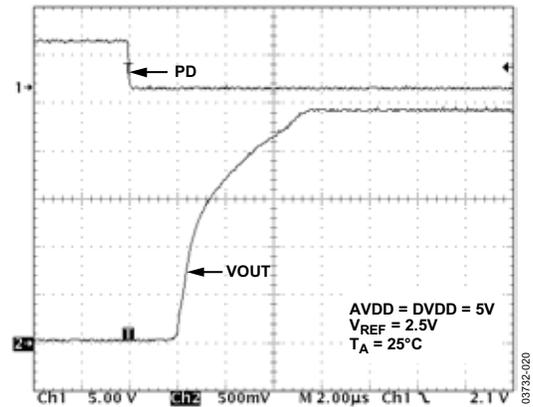


图20. 退出硬件省电模式

AD5381

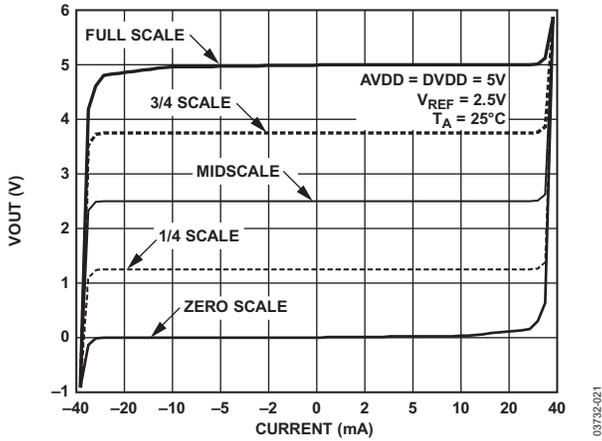


图21. AD5381-5输出放大器的源电流和吸电流能力

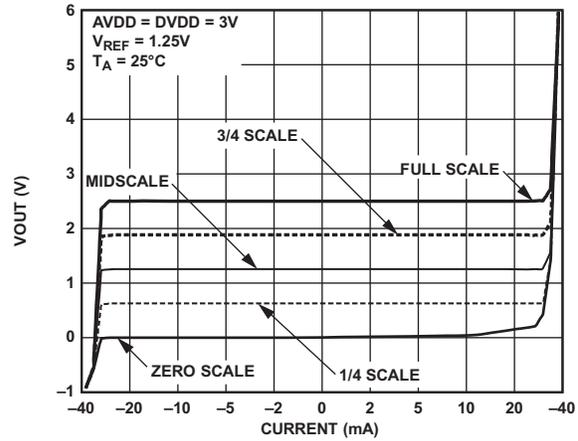


图24. AD5381-3输出放大器的源电流和吸电流能力

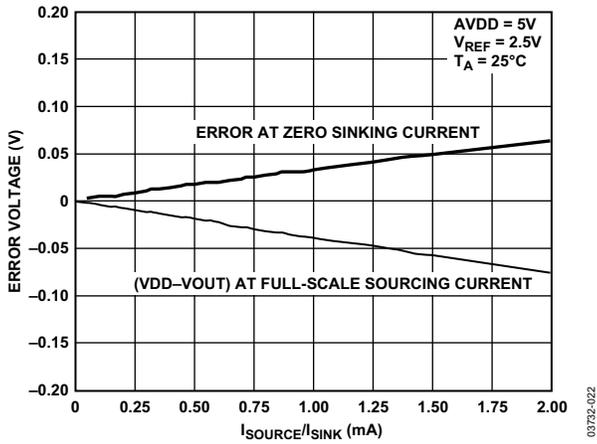


图22. 电压轨裕量与源电流/吸电流的关系

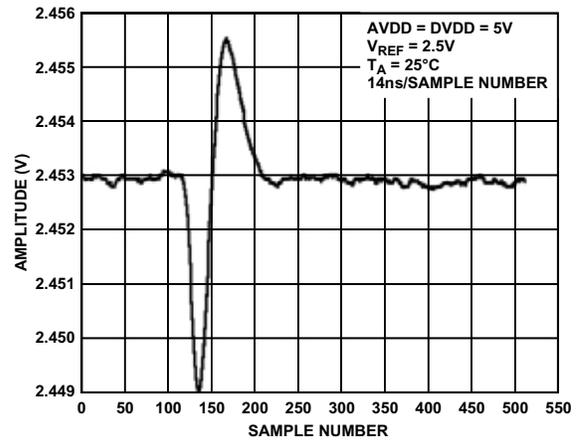


图25. 邻道DAC间串扰

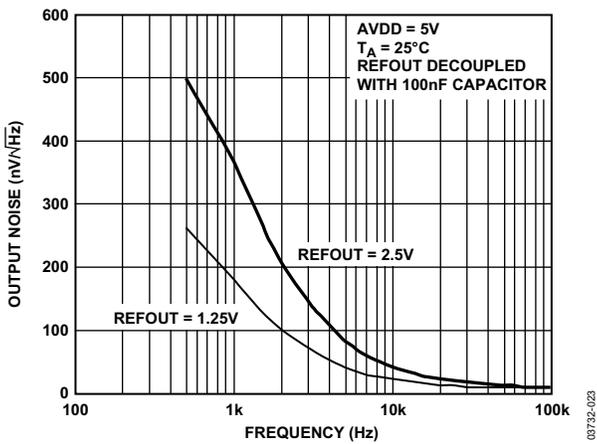


图23. REFOUT噪声频谱密度

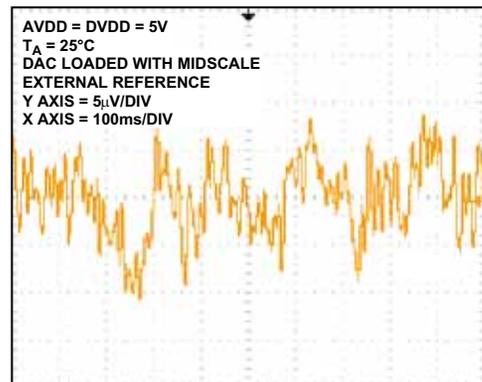


图26. 0.1 Hz至10 Hz噪声图

功能描述

DAC架构—通用

AD5381是一款完整的单电源、40通道电压输出DAC，提供12-bit分辨率。该器件采用100引脚LQFP封装，配备并行和串行接口。该产品内置一个可通过软件选择的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源，该电压源可用于驱动缓冲基准输入；或者也可以使用外部基准电压源来驱动这些输入。内部/外部基准电压源是通过控制寄存器中的CR8 Bit来选择的；如果选择了内部基准电压源，则CR10可选择基准幅度。所有通道均内置一个具有轨到轨输出的片内输出放大器，能够驱动与200 pF并联的5 kΩ负载。

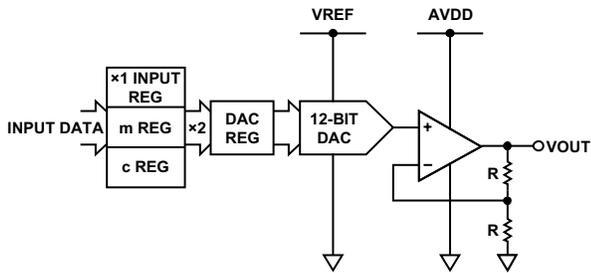


图27. 单通道架构

DAC单通道架构由一个12-bit电阻串DAC和其后的一个增益为2的输出缓冲放大器构成。这种电阻串架构可保证DAC的单调性。载入DAC寄存器的12-bit二进制数字码决定抽取电阻串上哪个节点的电压，以供给输出放大器。这类器件上的每个通道均包含独立的失调和增益控制寄存器，允许用户通过数字方式调整失调和增益。通过这些寄存器，用户能够使用内部m和c寄存器（保存校正系数）通过校准消除整个信号链（包括DAC）中的误差。所有通道均采用双缓冲机制，因而利用LDAC引脚可以同步更新所有通道。图27所示为AD5381上单个通道的框图。各DAC的数字输入传递函数可以表示为：

$$x2 = [(m + 2) / 2^n \times x1] + (c - 2^{n-1})$$

其中：

$x2$ 为载入电阻串DAC的数据字。

$x1$ 为写入DAC输入寄存器的12-bit数据字。

m 为增益系数（默认为0xFFE）。该增益系数写入11个最高有效位（DB11至DB1），而数据字的LSB（DB0）为0。

n 为DAC分辨率（对于AD5381， $n = 12$ ）。

c 为12-bit失调系数（默认为0x800）。

这些器件的完整传递函数可以表示为：

$$V_{OUT} = 2 \times V_{REF} \times x2 / 2^n$$

其中：

$x2$ 为载入电阻串DAC的数据字。 V_{REF} 为施加于DAC REFOUT/REFIN引脚的外部基准电压。为了保证达到额定性能，建议AD5381-5采用2.5 V的外部基准电压，AD5381-3采用1.25 V的外部基准电压。

数据解码

AD5381内置12-bit数据总线DB11–DB0。根据REG1和REG0的值（参见表11）的不同，此数据将载入经过寻址的DAC输入寄存器、失调(c)寄存器或增益(m)寄存器。格式数据、失调(c)和增益(m)寄存器内容如表12或表14所示。

表11. 寄存器选择

REG1	REG0	所选寄存器
1	1	输入数据寄存器(x1)
1	0	失调寄存器(c)
0	1	增益寄存器(m)
0	0	特殊功能寄存器(SFR)

表12. DAC数据格式(REG1 = 1, REG0 = 1)

DB11 至 DB0			DAC输出(V)
1111	1111	1111	$2 V_{REF} \times (4095/4096)$
1111	1111	1110	$2 V_{REF} \times (4094/4096)$
1000	0000	0001	$2 V_{REF} \times (2049/4096)$
1000	0000	0000	$2 V_{REF} \times (2048/4096)$
0111	1111	1111	$2 V_{REF} \times (2047/4096)$
0000	0000	0001	$2 V_{REF} \times (1/4096)$
0000	0000	0000	0

表13. 失调数据格式(REG1 = 1, REG0 = 0)

DB11 至 DB0			失调(LSB)
1111	1111	1111	+2048
1111	1111	1110	+2047
1000	0000	0001	+1
1000	0000	0000	0
0111	1111	1111	-1
0000	0000	0001	-2047
0000	0000	0000	-2048

表14. 增益数据格式(REG1 = 0, REG0 = 1)

DB11 至 DB0			增益系数
1111	1111	1110	1
1011	1111	1110	0.75
0111	1111	1110	0.5
0011	1111	1110	0.25
0000	0000	0000	0

AD5381

片内特殊功能寄存器(SFR)

AD5381包含数个特殊功能寄存器(SFR)，具体如表15所列。SFR通过REG1 = REG0 = 0进行寻址并使用A5至A0地址位进行解码。

表15. SFR寄存器功能(REG1 = 0, REG0 = 0)

R/W	A5	A4	A3	A2	A1	A0	功能
X	0	0	0	0	0	0	NOP(无操作)
0	0	0	0	0	0	1	写入清零代码
0	0	0	0	0	1	0	软清零
0	0	0	1	0	0	0	软省电模式
0	0	0	1	0	0	1	软上电
0	0	0	1	1	0	0	控制寄存器写入
1	0	0	1	1	0	0	控制寄存器读取
0	0	0	1	0	1	0	监控通道
0	0	0	1	1	1	1	软复位

SFR命令

NOP(无操作)

REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 000000

不执行任何操作，但在串行回读模式下非常有用，可以逐个输出D_{OUT}上的数据来执行诊断。在NOP操作期间， $\overline{\text{BUSY}}$ 脉冲为低电平。

写入清零代码

REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 000001

DB11至DB0包含清零数据

通过 $\overline{\text{CLR}}$ 将线置为低电平或执行软清零功能，可以使用用户可配置的CLR寄存器中包含的数据来加载DAC寄存器的内容，并相应地设置VOUT0至VOUT39。这对于在清零状况下设置特定输出电压非常有用。此外，这也利于校准操作；用户可以将满量程或零刻度载入清零代码寄存器，然后调用硬件清零或软件清零功能将此代码载入所有DAC，从而不必对各DAC逐个执行写入。上电时默认为全0。

软清零

REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 000010

DB11至DB0 = 无关位

执行此指令可以执行清零，其功能与外部 $\overline{\text{CLR}}$ 引脚的功能相同。使用CLR代码寄存器中的数据加载DAC输出。完全执行软清零需要35 μs ，由 $\overline{\text{BUSY}}$ 低电平时间表示。

软省电模式

REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 001000

DB11至DB0 = 无关位

执行此指令可以执行全局省电功能，将所有通道置于低功耗模式，从而将模拟电源电流降至2 μA (最大值)并将数字电流降至20 μA (最大值)。在省电模式下，输出放大器可配置为高阻抗输出或提供100 k Ω 负载到地。省电模式下会保留所有内部寄存器的内容。省电模式下无法对任何寄存器执行写入。

软上电

REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 001001

DB11至DB0 = 无关位

此指令用于给输出放大器和内部基准电压源上电。退出省电模式所需时间为8 μs 。硬件省电和软件省电功能内置在OR数字功能中。

软复位

REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 001111

DB11至DB0 = 无关位

此指令用于执行软件复位。所有内部寄存器均复位至其默认值，即在满量程处对应于m，在零刻度处对应于c。DAC寄存器的内容被清零，所有模拟输出置0。软复位激活时间为135 μs 。

表16. 控制寄存器内容

MSB											LSB
CR11	CR10	CR9	CR8	CR7	CR6	CR5	CR4	CR3	CR2	CR1	CR0
控制寄存器写入/读取											
REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 001100, R/W状态决定操作是写入(R/W = 0)还是读取(R/W = 1)。DB11至DB0包含控制寄存器数据。											
控制寄存器内容											
CR11: 省电状态。此位用于配置省电模式下的输出放大器状态。											
CR11 = 1: 放大器输出为高阻抗(上电时默认)。											
CR11 = 0: 放大器输出为100 kΩ到地。											
CR10: 选择基准电压源(REF)。此位用于选择AD5381的内部工作基准电压源。CR10编程如下:											
CR10 = 1: 内部基准电压源为2.5 V(AD5381-5默认), 是建议AD5381-5使用的工作基准电压源。											
CR10 = 0: 内部基准电压源为1.25 V(AD5381-3默认), 是建议AD5381-3使用的工作基准电压源。											
CR9: 电流升压控制。此位用于提升输出放大器中的电流, 从而更改其压摆率。此位配置如下:											
CR9 = 1: 启用升压模式。这样可以使输出放大器中的偏置电流达到最大, 从而优化其压摆率, 不过会增加功耗。											
CR9 = 0: 禁用升压模式(上电时默认)。这样可以减小输出放大器中的偏置电流, 从而降低整体功耗。											
CR8: 内部/外部基准电压源。此位决定DAC是使用其内部基准电压源, 还是使用外部施加的基准电压源。											
CR8 = 1: 使能内部基准电压源。基准输出取决于载入CR10的数据。											
CR8 = 0: 选择外部基准电压源(上电时默认)。											
CR7: 通道监控使能(参见通道监控功能部分)。											
CR7 = 1: 使能监控。这样可以使能通道监控功能。对SFR寄存器中的监控通道执行写入后, 所选通道输出会路由至MON_OUT引脚。VOUT39在MON_OUT引脚上工作。											
CR7 = 0: 禁用监控(上电时默认)。禁用监控时, MON_OUT用作正常DAC输出功能。											
CR6: 热监控功能。使能时, 此功能用于监控AD5381的内部芯片温度。当温度超过130°C时, 热监控功能会关断输出放大器。当多个输出通道同时短路可能引起功耗超限时, 可以使用此功能来保护器件。如果芯片温度降至130°C以下, 软上电会重新使能输出放大器。											
CR6 = 1: 使能热监控。											
CR6 = 0: 禁用热监控(上电时默认)。											
CR5: 无关位。											
CR4至CR0: Toggle功能使能。此功能允许用户针对每个DAC, 在载入A和B寄存器的两个代码之间切换输出。控制寄存器的Bits CR4至CR0用于使各个八通道组能够在toggle模式下工作。对任意位写入逻辑1, 可以使能一个通道组; 写入逻辑0则会禁用一个组。LDAC用于在两个寄存器之间进行切换。											
表17.											
CR Bit	组	通道数									
CR4	4	32-39									
CR3	3	24-31									
CR2	2	16-23									
CR1	1	8-15									
CR0	0	0-7									
通道监控功能											
REG1 = REG0 = 0, A5至A0 = 001010											
DB11-DB6 = 包含用于寻址所监控通道的数据											
AD5381提供通道监控功能。此功能由一个通过接口寻址的多路复用器实现, 任意通道输出均可路由至MON_OUT引脚, 以便利用一个外部ADC进行监控。在通道监控模式下, VOUT39成为MON_OUT引脚, 所有受监控引脚均路由至此引脚。任何通道要路由至MON_OUT, 首先必须在控制寄存器中使能该通道监控功能。对于AD5381, DB11至DB6包含所监控通道的通道地址。选择通道地址63会使MON_OUT进入三态。											

AD5381

表18. AD5381通道监控解码

REG1	REG0	A5	A4	A3	A2	A1	A0	DB11	DB10	DB9	DB8	DB8	DB6	DB5-DB0	MON_OUT
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	X	VOUT0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X	VOUT1
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	X	VOUT2
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	X	VOUT3
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	X	VOUT4
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	X	VOUT5
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	X	VOUT6
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	X	VOUT7
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	X	VOUT8
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	VOUT9
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	VOUT10
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	X	VOUT11
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	X	VOUT12
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	X	VOUT13
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	X	VOUT14
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	X	VOUT15
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	X	VOUT16
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	X	VOUT17
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	X	VOUT18
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	X	VOUT19
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	X	VOUT20
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	X	VOUT21
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	X	VOUT22
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	X	VOUT23
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	X	VOUT24
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	X	VOUT25
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	X	VOUT26
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	X	VOUT27
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	X	VOUT28
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	X	VOUT29
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	X	VOUT30
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	X	VOUT31
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X	VOUT32
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	X	VOUT33
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	X	VOUT34
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	X	VOUT35
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	X	VOUT36
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	X	VOUT37
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	X	VOUT38
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	X	未定义
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	X	未定义
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	X	三态

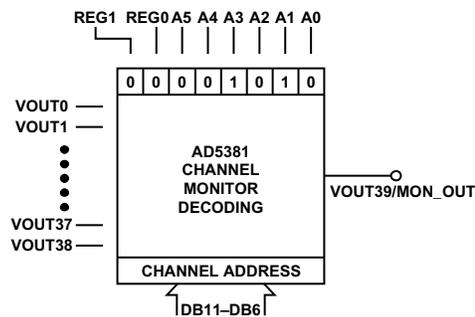


图28. 通道监控解码

硬件功能

复位功能

通过将RESET线置为低电平，可以将所有内部寄存器的内容复位到其上电复位状态。复位输入下降沿触发。默认设置在满量程处对应于m，在零刻度处对应于c。DAC寄存器的内容被清零，VOUT0至VOUT39设置为0 V。此序列耗时270 μs 。RESET的下降沿将启动复位过程。在此期间，BUSY将变为低电平，并在RESET完成后返回高电平。当BUSY处于低电平时，将禁用所有接口并忽略所有LDAC脉冲。当BUSY返回高电平时，器件恢复正常操作，并忽略RESET引脚的状态，直至检测到下一下降沿。

异步清零功能

通过将CLR线置为低电平，可以将DAC寄存器的内容清零至用户可配置CLR寄存器中包含的数据，并相应地设置VOUT0至VOUT39。此功能在系统校准中可用于将零刻度和满量程载入所有通道。CLR的执行时间为35 μs 。

BUSY 和LDAC功能

BUSY为CMOS数字输出，用于指示AD5381的状态。用户每次将新数据写入对应的x1、c或m寄存器时，器件都会计算x2的值，即载入DAC数据寄存器的内部数据。在计算x2期间，BUSY输出会变为低电平。在BUSY处于低电平时，用户可以继续将新数据写入x1、m或c寄存器，但DAC输出不会发生更新。将LDAC输入拉低，即可更新DAC输出。如果在BUSY有效时LDAC变为低电平，则将存储LDAC事件，并在BUSY变为高电平后立即更新DAC输出。用户可以将LDAC输入永久保持为低电平，这样DAC输出即会在BUSY变为高电平后立即更新。此外，在上电复位期间或在RESET引脚上检测到下降沿时，BUSY也会变为低电平。在此期间，所有接口都被禁用，LDAC上的所有事件都被忽略。

AD5381具有一项额外功能：自上一次LDAC被拉低以后，除非对x2寄存器中执行了写入，否则不会更新DAC寄存器。通常情况下，当LDAC被拉低时，器件会使用x2寄存器的内容来填充DAC寄存器。不过，AD5381只会在x2数据发生变化时更新DAC寄存器，因而消除了不必要的数字串扰。

并行模式下的FIFO操作

AD5381借助FIFO来优化并行接口模式下的操作。FIFO使能引脚(电平敏感、高电平有效)用于使能内部FIFO。连接到DVDD时，内部FIFO使能，从而允许用户全速写入器件。FIFO只能在并行接口模式下使用。器件会在上电时、CLR或RESET之后对FIFO EN引脚的状态进行采样，从而判断是否已使能FIFO。在串行或I²C接口模式下，FIFO EN应连接低电平。在并行模式下，器件能够以最大速度向FIFO中写入最多128条连续指令。FIFO写满后，将忽略对器件的进一步写入。图29所示为FIFO模式和非FIFO模式在通道更新时间方面的比较。图29还显示了数字加载时间。

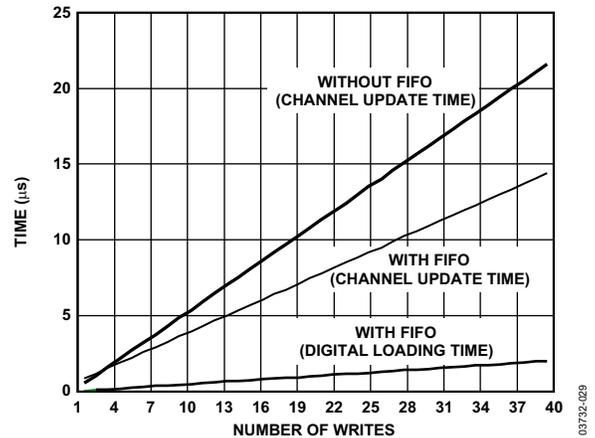


图29. 通道更新速率(FIFO与非FIFO)

上电复位

AD5381内置上电复位发生器和状态机。上电复位可以将所有寄存器复位至预定义状态并将模拟输出配置为高阻抗。在上电复位序列执行期间，BUSY引脚会变为低电平，从而防止向器件中写入数据。

省电模式

AD5381带有全局省电功能，可将所有通道置于低功耗模式，从而将模拟功耗降至2 μA (最大值)并将数字功耗降至20 μA (最大值)。在省电模式下，输出放大器可配置为高阻抗输出或提供100 k Ω 负载到地。省电模式下会保留所有内部寄存器的内容。退出省电模式时，先要经过放大器的建立时间后，输出才能达到并保持在其正确值。

接口

AD5381内置并行接口和串行接口。串行接口还可以编程为SPI、DSP、MICROWIRE或I²C兼容型接口。SER/ $\overline{\text{PAR}}$ 引脚用于选择并行和串行接口模式。在串行模式下， $\overline{\text{SPI/I}^2\text{C}}$ 引脚用于选择DSP、SPI、MICROWIRE或I²C接口模式。

该器件采用内部FIFO存储器，允许在并行接口模式下执行高速连续写入。在执行写指令时，用户可以继续将新数据写入器件中。 $\overline{\text{BUSY}}$ 信号指示器件的当前状态，在执行FIFO中的指令时该信号变为低电平。在并行模式下，器件能够以最大速度向FIFO中写入最多128条连续指令。FIFO写满后，将忽略对器件的进一步写入。

为了尽可能降低器件功耗和片内数字噪声，只有在 $\overline{\text{WR}}$ 下降沿或 $\overline{\text{SYNC}}$ 下降沿对器件执行写入时，活动接口才会完全上电。

DSP、SPI、MICROWIRE兼容型串行接口

串行接口在独立模式下工作最少采用三线，在菊花链模式下工作最少采用四线。菊花链方式允许将多个器件级联在一起，从而增加系统通道数。SER/ $\overline{\text{PAR}}$ 引脚必须连接高电平，而 $\overline{\text{SPI/I}^2\text{C}}$ 引脚(引脚97)则应连接低电平，以便使能DSP、SPI、MICROWIRE兼容型串行接口。在串行接口模式下，用户无需驱动并行输入数据引脚。串行接口的控制引脚如下：

$\overline{\text{SYNC}}$ 、DIN、SCLK—标准三线式接口引脚。

DCEN—选择独立模式或菊花链模式。

SDO—菊花链模式的数据输出引脚。

表19.40通道、12-bitDAC串行输入寄存器配置

MSB																LSB							
A/B	R/W	A5	A4	A3	A2	A1	A0	REG1	REG0	DB11	DB10	DB9	DB8	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	X	X

图3和图5所示为独立和菊花链模式下AD5381串行写入操作的时序图。串行接口的24-bit数据字格式如表19所示。

$\overline{\text{A/B}}$ ：使能toggle模式时，此引脚用于选择将数据写入A寄存器还是B寄存器。禁用toggle模式时，此位位置0，以选择A数据寄存器。

$\overline{\text{R/W}}$ 是读写控制位。

A5至A0用于寻址输入通道。

REG1和REG0用于选择要写入数据的寄存器，如表11所示。

DB11至DB0包含输入数据字。

X表示无关。

独立模式

通过将DCEN(菊花链使能)引脚连接到低电平，可以使能独立模式。串行接口采用连续式和非连续式两种串行时钟工作。 $\overline{\text{SYNC}}$ 的第一个下降沿启动写周期并复位用于计算串行时钟数的计数器，以确保将正确的位数移入串行移位寄存器。器件会忽略 $\overline{\text{SYNC}}$ 上除下降沿之外的所有其他边沿，直到读入24个位。移入24个位后，器件会忽略SCLK。为了进行其他串行传输，必须通过 $\overline{\text{SYNC}}$ 下降沿来复位计数器。

菊花链模式

对于包含数个器件的系统，可利用SDO引脚通过菊花链方式将多个器件连接起来。菊花链模式有助于系统诊断和减少串行接口线的数量。

通过将DCEN(菊花链使能)引脚连接到高电平，可以使能菊花链模式。 $\overline{\text{SYNC}}$ 的第一个下降沿启动写周期。当 $\overline{\text{SYNC}}$ 为低电平时，SCLK不断施加到输入移位寄存器。如果施加了24个以上的时钟脉冲，则数据从移位寄存器纹波输出并出现在SDO线路上。此数据在SCLK上升沿逐个输出，并在SCLK的下降沿有效。将第一个器件的SDO连接到菊花链中下一个器件的DIN输入，可构建一个多器件接口。系统中每个器件均需要24个时钟脉冲。因此，时钟周期的总数必须为 $24N$ ，其中 N 为链中AD538x的总数。

当对所有器件的串行传输结束时， $\overline{\text{SYNC}}$ 变为高电平，这样可以锁存菊花链中各器件的输入数据，防止额外的数据进入输入移位寄存器。

如果在24个时钟写入器件之前 $\overline{\text{SYNC}}$ 变为高电平，则这会被视为坏帧，数据会被丢弃。

串行时钟可以是连续时钟或选通时钟。只有当 $\overline{\text{SYNC}}$ 可以在正确的时钟周期数内保持为低电平时，才能使用连续的SCLK时钟源。在选通时钟模式下，必须采用包含确切时钟周期数的突发时钟，在时钟周期结束后必须将 $\overline{\text{SYNC}}$ 置为高电平来锁存数据。

回读模式

回读模式通过在串行输入寄存器写操作时设置 R/\overline{W} bit = 1来调用。利用 $R/\overline{W} = 1$ 、Bits A5至A0，以及Bits REG1和REG0，可以选择要读取的寄存器。写序列中其余的数据位则与之无关。在下一次SPI写操作时，SDO输出端的数据包含之前寻址寄存器的数据。

当读取单个寄存器时，可以使用NOP命令通过SDO从选定的寄存器输出数据。图30显示了回读顺序。例如，要回读AD5381上通道0的m寄存器，应当实施如下操作序列：首先，将0x404XXX写入AD5381输入寄存器。这会将AD5381配置为读取模式，同时选中通道0的m寄存器。注意数据Bits DB11至DB0是无关位。然后执行第二个写操作，写入NOP条件0x000000。

在此写入期间，来自m寄存器的数据在DOOUT线路上逐个输出，即所输出数据在Bit DB11至Bit DB0中包含来自m寄存器的数据，而高十位包含之前写入的地址信息。在回读模式下， $\overline{\text{SYNC}}$ 信号必须使能数据帧。数据在SCLK上升沿逐个输出，而且在SCLK信号的下降沿有效。如果SCLK在回读操作的读写操作之间处于空闲高电平状态，数据的第一个位会在 $\overline{\text{SYNC}}$ 下降沿输出。

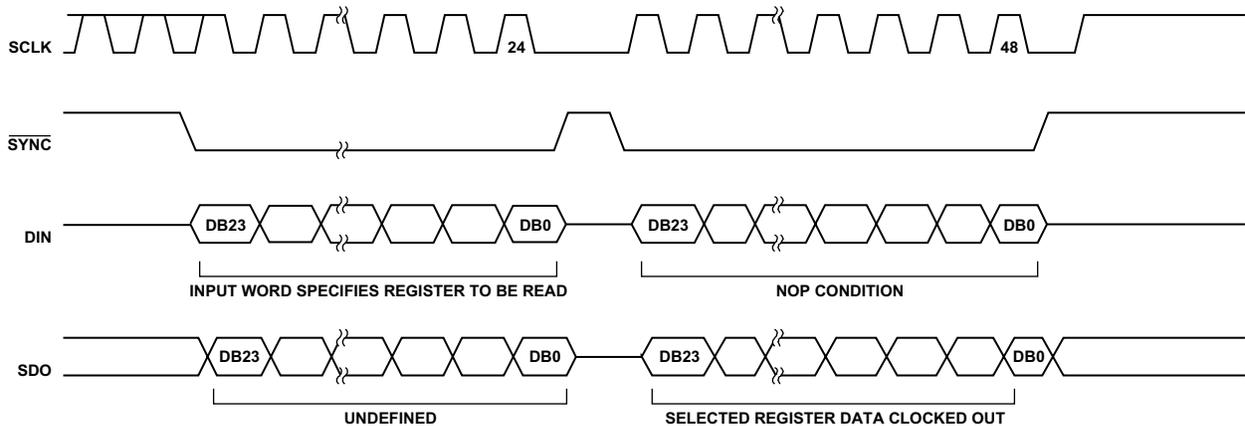


图30. 串行回读操作

03732-030

AD5381

I²C串行接口

AD5381具有一个I²C兼容型双线式接口，由一条串行数据线(SDA)和一条串行时钟线(SCL)构成。SDA和SCL支持AD5381和主机之间以最高400 kHz的速率进行通信。图6显示了三种不同工作模式下的双线式接口时序图。在选择I²C工作模式时，首先配置串行工作模式(SER/PAR= 1)，然后将SPI/I²C引脚配置为逻辑1来选择I²C模式。器件以从机形式连接到I²C总线(即AD5381不产生任何时钟)。AD5381拥有一个7-bit从机地址，即10101(AD1)(AD0)。5位MSB采用硬编码，而2位LSB则由AD1和AD0引脚的状态决定。AD1和AD0的硬件配置功能允许在总线上配置其中四个器件。

I²C数据传输

每个SCL时钟周期内会传输一个数据位。在SCL时钟脉冲的高电平期间，SDA上的数据必须保持稳定。SCL处于高电平时SDA的变化成为控制信号，用于配置起始和停止条件。当I²C总线空闲时，器件会通过外部上拉电阻将SDA和SCL上拉至高电平。

起始条件和停止条件

主器件通过发出起始条件来发起通信。起始条件是指SCL处于高电平时，SDA上发生的高电平至低电平跃迁。停止条件是指SCL处于高电平时，SDA上发生的低电平至高电平跃迁。主机发出起始条件表示开始向AD5381进行传输。停止条件则会释放总线。如果生成的是重复起始条件(Sr)，而非停止条件，则总线会保持活动状态。

重复起始条件

重复起始(Sr)条件可以指示总线上数据方向的变化。当总线主机向数个I²C器件执行写入操作并希望保持总线控制时，就可以使用Sr。

应答位(ACK)

应答位(ACK)是附加到任何8-bit数据字的第九个位。ACK始终由接收器件生成。在第九个时钟周期内，AD5381器件会在接收地址或数据时通过拉低SDA来生成ACK。通过监控ACK，可以检测出失败的数据传输。如果接收器件处于忙碌状态或发生了系统故障，数据传输就会失败。数据传输失败时，总线主机应会重新尝试进行通信。

AD5381从机地址

总线主机通过发出一个起始条件以及7-bit从机地址来发起与从机的通信。闲置时，AD5381会等待起始条件及其从机地址。地址字的LSB部分是读/写(R/W)位。AD5381为只收器件；与AD5381进行通信时， $\overline{R/W}=0$ 。收到正确地址10101(AD1)(AD0)后，AD5381会在一个时钟周期内拉低SDA来发出ACK。

AD5381拥有四种不同的用户可编程地址，具体由AD1和AD0 Bits决定。

写操作

数据可以通过三种特定模式写入AD5381 DAC。

4字节模式

写入AD5381 DAC时，用户必须先写入地址字节($\overline{R/W}=0$)，接着DAC通过拉低SDA做出应答，表示其已做好接收数据准备。地址字节之后是指针字节；这会对DAC中要寻址的特定通道进行寻址，并且也由DAC做出应答。然后向DAC中写入两个字节的数，如图31所示。接着是停止条件。这允许用户随时更新AD5381中的单个通道并要求从主机传输四个字节的数。

3字节模式

在3字节模式下，用户可以更新写序列中的多个通道，而无需每次都写入器件地址。器件地址字节只需要提供一次；后续通道更新需要的是指针字节和数据字节。在3字节模式下，用户首先写入地址字节($\overline{R/W}=0$)，接着DAC通过拉低SDA做出应答，表示其已做好数据接收准备。地址字节之后是指针字节。这会对DAC中要寻址的特定通道进行寻址，并且也由DAC做出应答。在此之后则是两个数据字节。REG1和REG0决定要更新的寄存器。

如果数据字节之后未出现停止条件，那么将通过发送新的指针字节后跟数据字节来更新另一通道。器件完成最初寻址之后，此模式只需要发送三个字节即可更新任意通道，从而减少了更新AD5381通道的软件开销。无论何时，只要出现停止条件，即可退出此模式。图32所示为典型配置。

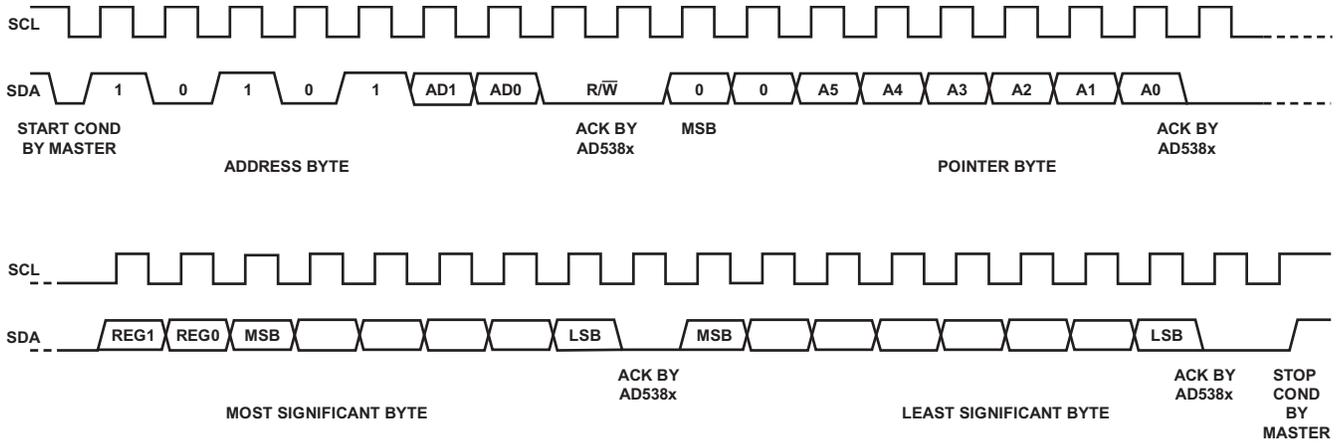


图31. 4字节AD5381 I²C写操作

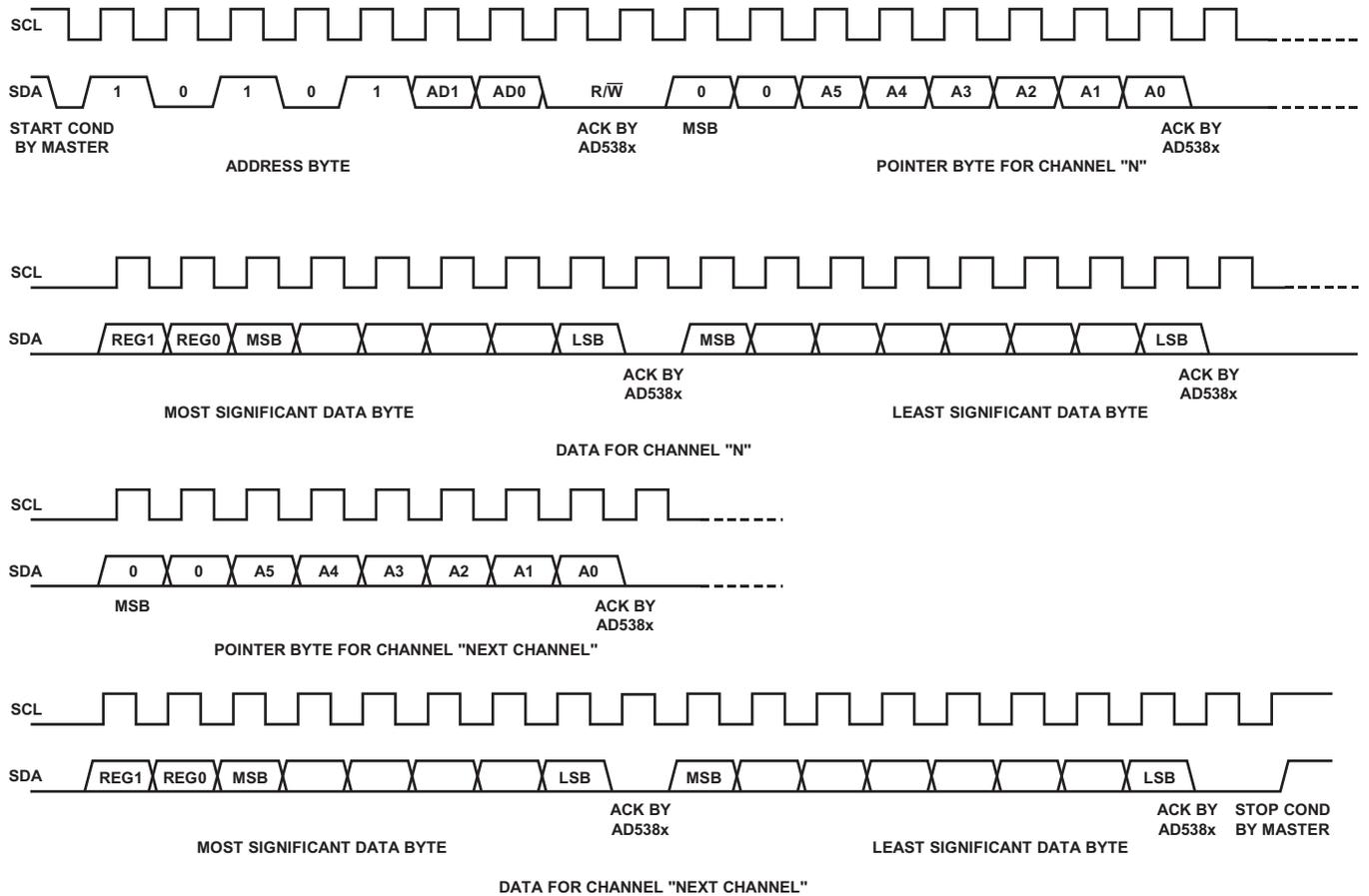


图32. 3字节AD5381 I²C写操作

AD5381

2字节模式

初始化2字节模式之后，用户可以按顺序更新多个通道。器件地址字节只需要提供一次，而地址指针配置为自动递增或突发模式。

用户必须先写入地址字节($R/\overline{W} = 0$)，接着DAC通过拉低SDA做出应答，表示其已做好数据接收准备。地址字节之后是特定指针字节(0xFF)，从而启动突发工作模式。地址指针初始化为通道0，该指针后跟的数据会被载入通道0，而地址指针会自动递增至下一地址。

数据字节中的REG0和REG1 bits决定要更新的寄存器。在此模式下，完成初始化后，只需两个数据字节即可更新一个通道。通道地址会自动从通道0递增至通道39，然后返回到正常的3字节工作模式。此模式允许将数据传输至一个模块内的所有通道，从而减小了配置所有通道时的软件开销。无论何时，只要出现停止条件，即可退出此模式。2字节模式不支持Toggle模式。图33所示为典型配置。

并行接口

要使能并行接口并禁用串行接口， $\overline{SER}/\overline{PAR}$ 必须连接低电平。图7给出了并行写入的时序图。并行接口由以下引脚控制：

\overline{CS} 引脚

低电平有效器件选择引脚。

\overline{WR} 引脚

引脚A5至A0上的地址在 \overline{CS} 处于低电平时在 \overline{WR} 的上升沿锁存；数据总线上的数据会被载入所选输入寄存器。

REG0、REG1引脚

REG0和REG1引脚决定向AD5381中写入数据时的目标寄存器。参见表11。

引脚A5至A0

40个DAC通道可以逐个分别进行寻址。

引脚DB11至DB0

AD5381在DB11至DB0上接受一个12-bit直接并行字，其中DB11为MSB，而DB0则为LSB。

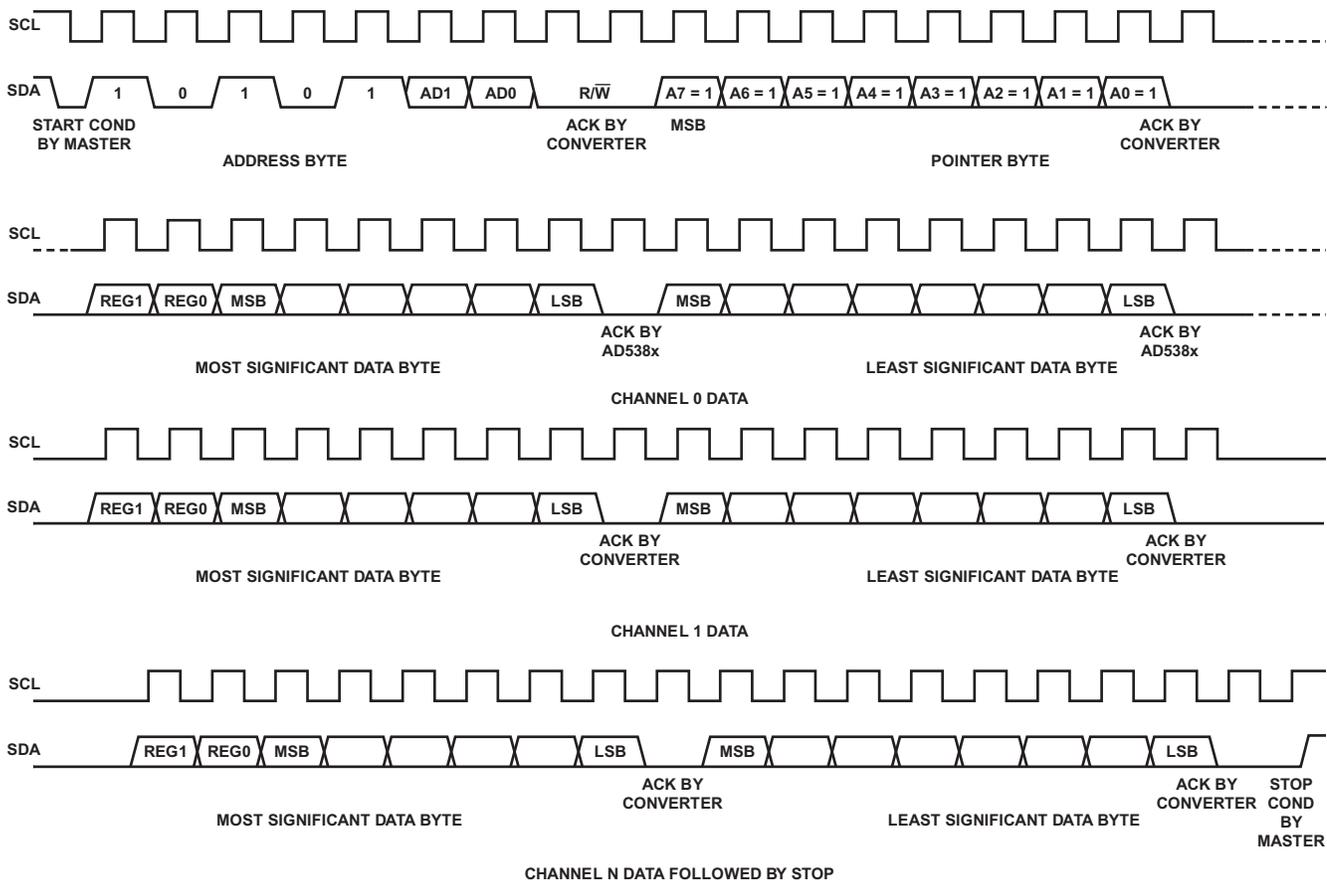


图33. 2字节I²C写操作

微处理器接口

并行接口

AD5381可以与各种16-bit微控制器或DSP处理器接口。图35所示为与通用16-bit微控制器/DSP处理器接口的AD5381系列。处理器的低位地址线与AD5381上的A0至A5相连。而高位地址线则经过解码，向AD5381提供 \overline{CS} 、 \overline{LDAC} 信号。AD5381具有快速接口时序特性，可以与多种微控制器和DSP直接接口，如图35所示。

AD5381至MC68HC11

MC68HC11上的串行外设接口(SPI)配置为主机模式(MSTR = 1)，时钟极性位(CPOL)为0，时钟相位位(CPHA)为1。SPI则通过向SPI控制寄存器(SPCR)执行写入来进行配置—参见《MC68HC11用户手册》。MC68HC11的SCK驱动AD5381的SCLK，MOSI输出驱动AD5381的串行数据线(D_{IN})，而MISO输入则通过D_{OUT}驱动。SYNC信号由端口线(PC7)获得。

向AD5381发送数据时， \overline{SYNC} 线被拉低(PC7)。MOSI输出端上的数据在SCK的下降沿有效。来自MC68HC11的串行数据以8-bit字节传送，在传送周期中仅出现8个时钟下降沿。

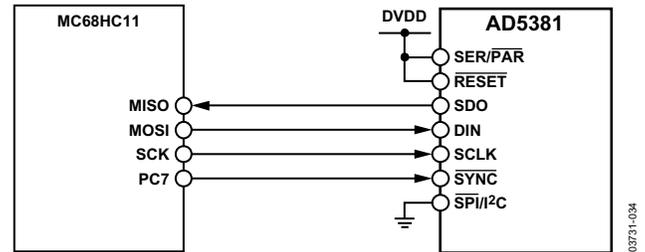
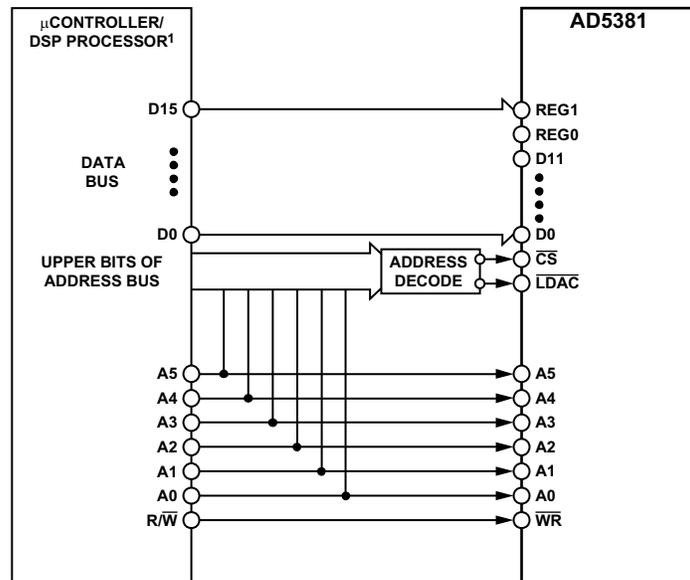


图34. AD5381至MC68HC11接口



¹ADDITIONAL PINS OMITTED FOR CLARITY.

图35. AD5381至并行接口

AD5381

AD5381至PIC16C6x/7x

PIC16C6x/7x同步串行端口(SSP)配置为SPI主机, 时钟极性位为0。这是通过向同步串行端口控制寄存器(SSPCON)执行写入而实现的。参见《PIC16/17微控制器用户手册》。在此I/O示例中, 端口RA1用于通过脉冲激活 $\overline{\text{SYNC}}$ 并使能AD5381的串行端口。在每个串行传输操作中, 此微控制器仅传输八个字节的数据; 因此, 根据具体模式的不同, 可能需要三个连续的读/写操作。图36给出了连接图。

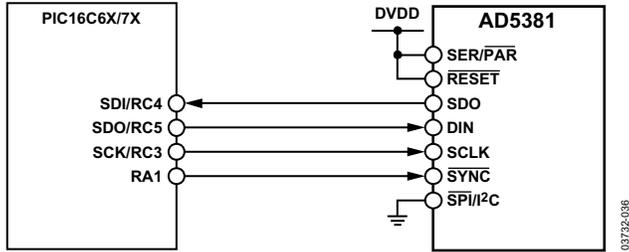


图36. AD5381至PIC16C6x/7x接口

AD5381至8051

AD5381要求时钟与串行数据同步。因此, 8051串行接口必须在模式0下工作。在此模式下, 串行数据会通过RxD进入和退出, 而移位时钟是TxD上的输出。图37给出了8051连接到AD5381的方式。由于AD5381在移位时钟的上升沿移出数据并在下降沿锁存数据, 因此移位时钟必须反相。AD5381要求其数据以MSB为优先。由于8051首先输出LSB, 因此发送例程需要考虑这一情况。

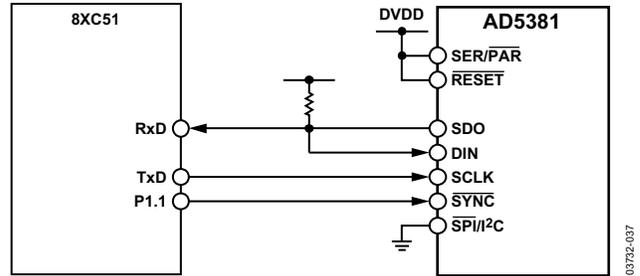


图37. AD5381至8051接口

AD5381至ADSP-2101/ADSP-2103

图38显示的是AD5381与ADSP-2101/ADSP-2103之间的串行接口。ADSP-2101/ADSP-2103应该设置为SPORT交替帧传输模式。ADSP-2101/ADSP-2103 SPORT通过SPORT控制寄存器进行编程并应该按照如下方式进行配置: 内部时钟工作模式、低电平有效帧和16-bit字长。使能SPORT后, 可以通过对Tx寄存器进行写操作来启动传输。

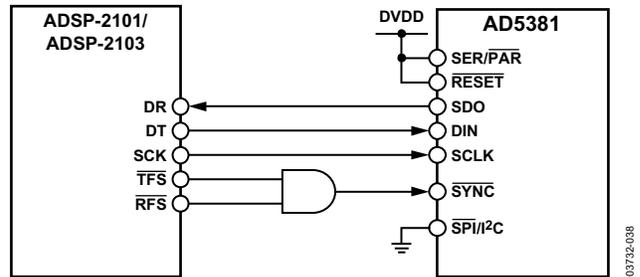


图38. AD5381至ADSP-2101/ADSP-2103接口

应用信息

电源去耦

在任何注重精度的电路中，精心考虑电源和接地回路布局都有助于确保达到规定的性能。AD5381所在的印刷电路板在设计时应将模拟部分与数字部分分离，并限制在电路板的特定区域内。如果AD5381系统内有多个器件要求AGND连到DGND，则应采用单点接地，这一星型接地点的位置应尽量靠近该器件。

对于具有多个引脚(AVDD和DVDD)的电源，建议将这些引脚连接在一起。AD5381应当具有足够大的10 μF 电源旁路电容，与每个电源上的0.1 μF 电容并联，并且尽可能靠近封装，最好是正对着该器件。10 μF 电容应为钽珠型电容。0.1 μF 电容应具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL)，如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容，以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。

AD5381的电源线路应采用尽可能宽的走线，以提供低阻抗路径，并减小电源线路上的毛刺效应。时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来，以免向电路板上的其它器件辐射噪声，并且绝不应靠近基准输入。DIN线路与SCLK线路之间布设接地线路有助于降低二者之间的串扰(多层电路板上具有独立的接地层，因此不需要这样做，但分开不同线路总有益处)。必须将REFOUT/REFIN线路上的噪声降至最低。

避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相对两侧上的走线应当彼此垂直，这样做有助于减小电路板上的馈通效应。微带线技术是目前的最佳选择，但这种技术对于双面电路板未必总是可行。采用这种技术时，电路板的元件侧专用于接地层，而信号走线则布设在焊接侧。

典型配置电路

图39所示为采用外部基准电压源的AD5381-5典型配置。在所示电路中，所有AGND、SIGNAL_GND和DAC_GND引脚均连在一起，并连接至一个公共的AGND。在AD5381器件上，AGND与DGND连在一起。上电时，AD5381默认采用外部基准电压源工作。所有AVDD线路均相连并采用相同的5 V电源驱动。建议使用0.1 μF 陶瓷电容和10 μF 钽电容，对靠近器件的电源进行去耦。本应用中，AD5381-5的基准电压从2.5 V外部基准电压源ADR421或ADR431获得。

适合AD5381-3的外部基准电压源包括1.2 V基准电压源ADR280。应使用0.1 μF 电容在器件的REFOUT/REFIN引脚对基准电压源去耦。

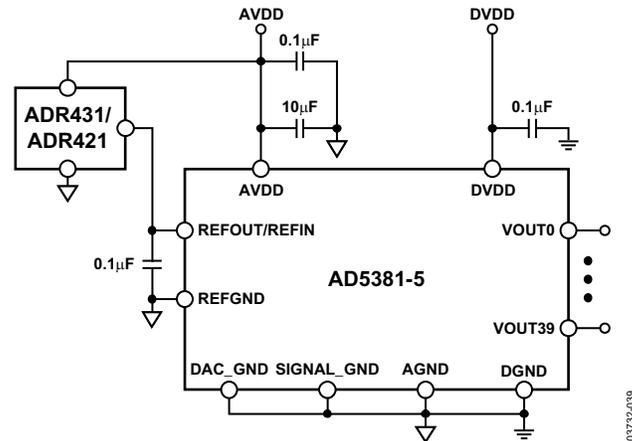


图39. 采用外部基准电压源的典型配置

图40所示为采用内部基准电压源的典型配置。上电时，AD5381默认采用外部基准电压源工作；因此，需要通过向AD5381控制寄存器执行写入来配置和开启内部基准电压源。控制寄存器Bit CR10允许用户选择基准电压值；Bit CR8用于选择内部基准电压源。AVDD = 5 V时，建议使用2.5 V基准电压源，而AVDD = 3 V时则建议使用1.25 V基准电压源。

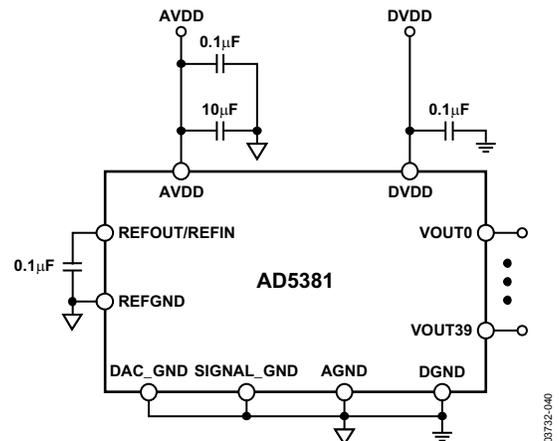


图40. 采用内部基准电压源的典型配置

为清楚起见，忽略了数字连接。AD5381内置省电模式时间为10 ms的上电复位电路。如果电源斜坡率超过10 ms，用户应当在初始化过程中复位AD5381，以确保正确地将校准数据载入器件。

AD5381

监控功能

AD5381通道监控功能由一个通过接口寻址的多路复用器实现，任意通道输出均可路由至此引脚，以便利用一个外部ADC进行监控。在通道监控模式下，VOUT39成为MON_OUT引脚，所有受监控信号均路由至此引脚。任何通道要路由至MON_OUT，首先必须在控制寄存器中使能该通道监控功能。表18包含要将任意通道路由至MON_OUT所需的解码信息。选择通道地址63会使MON_OUT进入三态。图41所示为采用6引脚SOT-23封装的12-bit SAR ADC实现的典型监控电路。控制器输出端口用于选择要监控的通道，而输入端口则用于读取ADC转换的数据。

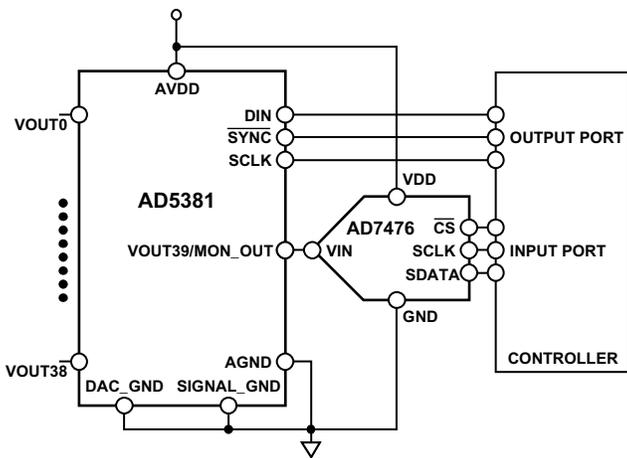


图41. 典型通道监控电路

Toggle模式功能

Toggle模式功能允许采用在两个DAC数据寄存器之间切换的LDAC控制信号来生成输出信号。此功能是通过SFR控制寄存器按照下述方式进行配置的。REG1 = REG0 = 0且A5至A0 = 001100的写操作指定了控制寄存器的写入。Toggle模式功能是采用控制寄存器中的Bit CR4至Bit CR0在八通道组中使能的。参见AD5381控制寄存器描述。图42所示为实现toggle模式的框图。AD5381上共有40个DAC通道，每个通道均包含A和B数据寄存器。

请注意，仅在使能toggle模式时，才能加载B寄存器。将AD5381配置为toggle模式时的事件顺序如下：

1. 通过控制寄存器为所需通道使能toggle模式。
2. 将数据载入A寄存器。
3. 将数据载入B寄存器。
4. 施加LDAC。

LDAC 用于在A和B寄存器之间切换，从而决定模拟输出。第一个LDAC将输出配置为反映A寄存器中的数据。如果用户希望在所有40个通道的输出端生成方波(如在驱动液晶可变光衰减器时)，则此模式具有显著优势。

本例中，用户写入控制寄存器并使能toggle功能，方法是将CR4至CR2设置为0，从而为八组中的五组使能toggle工作模式。然后，用户必须将数据载入所有40个A和B寄存器。切换LDAC可将输出值设置为反映A和B寄存器中的数据。LDAC的频率决定方波输出的频率。

通过控制寄存器将Toggle模式禁用。禁用toggle模式后的第一个LDAC使用A寄存器中包含的数据来更新输出。

热监控功能

AD5381具有热关断功能，可在多个输出端短接时保护芯片。各输出放大器的短路电流通常为40 mA。在5 V下使用AD5381时，每个短路放大器的功耗为200 mW。五个通道短接时，这样会造成额外的功耗。对于100引脚LQFP封装， θ_{JA} 典型值为44°C/W。

用户可以通过控制寄存器中的CR6来使能热监控。如果芯片温度超过约130°C，AD5381上的输出放大器会自动进入省电模式。发生热关断后，用户可以通过在温度降至130°C以下时执行软上电，或者通过控制寄存器关闭热监控功能来重新使能器件。

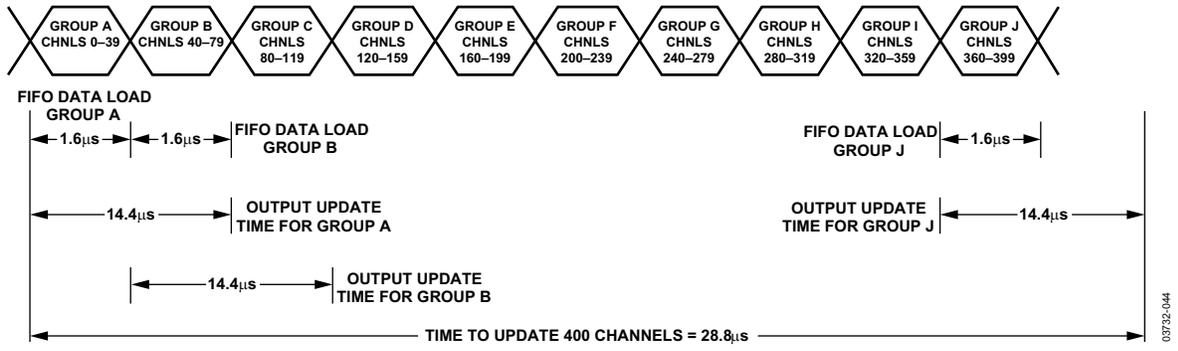


图44. 使用FIFO模式更新400个通道的时间小于 $30\mu\text{s}$

AD5381

注释

注释

注释

I²C指最初由Philips Semiconductors(现为NXP Semiconductors)开发的一种通信协议。

©2004–2012 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
D03732sc-0-5/12(C)



www.analog.com